

## 業 務

### 概覽

#### 我們是誰

我們是全球最大的PCB直接成像設備供應商，於AI時代提供PCB直接成像設備及半導體直寫光刻設備。我們憑藉在核心高精度微納光刻技術研發以及將自有技術應用於各種創新應用的成熟能力，致力於為全球客戶製造、銷售及維護直接成像及直寫光刻設備。根據灼識諮詢的資料，按2024年的營業收入計，我們是全球最大的PCB直接成像設備供應商，市場份額為15.0%。於同年，按營業收入計，我們最接近的競爭對手的市場份額為13.7%，而其他主要競爭對手的市場份額亦相若。根據灼識諮詢的資料，截至2025年6月30日，我們是全球唯一一家商業化產品覆蓋全部PCB、IC載板、先進封裝及掩膜版應用的公司，是國內僅有的兩家商業化產品覆蓋先進封裝應用的公司之一，也是國內僅有的三家產品覆蓋掩膜版應用的公司之一。我們已在先進封裝領域建立穩定的客戶基數，並於往績記錄期間及截至最後實際可行日期服務16名客戶。

根據灼識諮詢的資料，直接成像及直寫光刻設備乃集成電路及相關產業價值鏈中最關鍵及最精密生產工藝之一的核心設備。我們高度創新、高效且可靠的無掩膜光刻技術及設備可滿足高端印製電路板製造、先進封裝、IC載板、掩膜製作及新型顯示面板應用日益複雜的需求。我們持續擴大全球佈局，加強與上下游產業的協同合作，並優化我們的供應鏈體系及技術，以獲得競爭優勢。

我們擁有涵蓋光源及曝光引擎、精密工件台、對準對焦、數據鏈路、系統模塊化集成設計等在內的完整研發技術體系架構。我們專注於提供創新、穩定、可靠的微納直寫光刻設備，致力於為客戶實現價值最大化。於往績記錄期間，我們的產品主要包括PCB直接成像設備及自動線系統、半導體直寫光刻設備及自動線系統。截至2025年12月31日，我們已為超過600家客戶提供近100種類型的PCB直接成像設備和半導體直寫光刻設備，根據灼識諮詢的資料，截至2025年6月30日，客戶涵蓋全球全部十大PCB製造商及全球百強PCB製造商中的七成。根據灼識諮詢的資料，截至2025年6月30日，我們的直寫光刻設備產品組合覆蓋的下游應用場景為全球公司中最廣。

---

## 業 務

---

### 市場機遇

根據灼識諮詢的資料，微納直寫光刻設備市場受PCB直接成像設備市場、先進封裝市場、IC載板市場、掩膜版市場及新型顯示市場的增長所推動，展現出廣闊的增長潛力。

- **PCB直接成像設備**。PCB直接成像設備的需求受到AI、5G、雲計算及物聯網等技術發展的影響，該等技術發展促進了消費電子、新能源汽車及AI服務器等下游行業的變革。該等發展已導致需求逐步轉向具有更高精度、效率及運行穩定性的PCB製造設備。
- **先進封裝**。隨著AI、高性能計算、5G通訊及汽車電子等應用對計算性能及能源效率的要求日益提高，先進封裝市場不斷擴大。隨著先進封裝的應用日益廣泛，預計用於先進封裝應用的直寫光刻設備的需求將與整體行業發展同步增長。
- **IC載板**。由於芯片集成度提高以及系統級和先進封裝解決方案的使用增加，IC載板市場得以增長。IC載板支持高密度互連及複雜的系統集成，預計該分部的持續發展將支持用於IC載板製造的直寫光刻設備的需求。
- **掩膜製作**。由於掩膜版是半導體製造的必要組件，其需求與全球集成電路行業的增長掛鉤。預計用於掩膜製作的直寫光刻設備市場將隨掩膜版市場一同擴大，而國內供應商或會受益於進口設備的替代。
- **新型顯示面板**。新型顯示面板應用於一系列電子設備，包括智能手機、平板電腦、電視及顯示器。對更高解析度及更高能源效率的需求，支持了平板顯示器市場的持續發展，繼而預計將有助於增加對用於面板顯示器製造的直寫光刻設備的需求。

## 業 務

### 我們的主要成就

下表載列我們的若干主要成就：



附註：

- (1) 據灼識諮詢的資料，按2024年的營業收入計。
- (2) 據灼識諮詢的資料，截至2025年6月30日。
- (3) 截至2025年12月31日。
- (4) 截至最後實際可行日期。

## 業 務

### 競爭優勢

#### 於龐大且不斷演變的微納直寫光刻市場為重要參與者

直寫光刻技術應用領域廣泛，包括PCB領域各細分產品，如多層板、HDI板、柔性板等，覆蓋了PCB各種制程工藝，提供更高的精度及效率。近年來，激光直寫光刻技術的應用亦已擴展至半導體領域，包括先進封裝、MEMS、IC載板、陶瓷器件及鍵合應用場景。根據灼識諮詢的資料，微納直寫光刻設備市場受PCB直接成像設備、先進封裝、IC載板、掩膜版及新型顯示的市場需求增長所推動，展現出廣闊的增長潛力。預計全球微納直寫光刻設備市場規模將從2024年的人民幣112億元增長至2030年的人民幣190億元，複合年增長率為9.2%。

根據灼識諮詢的資料，我們是全球最大的PCB直接成像設備供應商，在PCB及半導體設備方面擁有領先的市場份額及先發優勢。我們作為微納直寫光刻行業的頭部企業，將充分把握高端PCB市場需求增長及以先進封裝領域為代表的半導體市場帶來的發展機遇，憑藉我們的產品質量、先進技術和市場領先地位，持續為客戶提供多樣化的產品和解決方案，從而滿足行業發展需求。

#### 我們的微納直寫光刻技術具有全球競爭力，主要性能指標處於國際一流梯隊

自成立以來，我們始終堅持以自主研發為主的研發模式，不斷完善IPD研發管理體系。依據公司完善的產品路標與技術規劃平台，通過整合光學、精密機械、電子、軟件算法和系統工程方面的專業技術，我們已形成了完整的研發體系架構。該架構包括光源及曝光引擎、精密工件台、對準對焦、圖形處理、系統監測及自動化標定、數據鏈路及模塊化集成設計等核心部件，為創新及產品開發奠定了完整且可擴展的基礎。通過多年深耕微納直寫光刻設備的研發和生產，以及與各類終端應用場景的深度耦合，我們構建技術和產品的「組合壁壘」，能夠根據客戶需求提供高性能、可靠和經濟高效的定制解決方案。例如，憑藉我們先進的光刻紫外光源及曝光引擎技術，我們的高功率阻焊層型號支持高達200W的功率及三波段組合光源，適用於各種阻焊油墨；我們的MAS6P系列設備採用二次成像技術，實現最大掃描寬度24.5英寸，產能高達每小時120片，並已成功應用於高端HDI及IC載板產品的量產。此外，我們的系統監測及自動化標定技術採用了自研算法，可在60秒內無需人工干預，自動完成光學、平台、對準、環境控制及數據鏈路子系統間的空間關係標定。該技術實現微米級補償，顯著縮短標定時間，並減少人為誤差。

## 業 務

我們致力於打造具有全球競爭力的創新研發團隊，持續保障核心技術的先進性。截至2025年12月31日，我們共有研發人員281人，佔總人數比例約三分之一以上。憑藉豐富的技術積累，形成以直寫光刻技術為核心的自主知識產權體系。截至最後實際可行日期，我們在中國已獲得237項註冊專利、54項註冊軟件著作權、25項註冊商標及兩項域名，以及一項在日本的有效專利。2024年，我們主導起草的GB/T 43725-2024《直寫成像式曝光設備》國家標準已通過審核並於2024年3月15日發佈。

我們的研發部門由多個專業研發團隊組成，專注於微納直寫光刻設備的核心技術、關鍵零部件及核心子系統，以避免對第三方依賴，並確保供應及使用。關鍵技術攻關圍繞提升直寫式光刻系統關鍵技術性能指標包括解析能力、對位精度等，持續改善設備的穩定性、可靠性和兼容性，在PCB和半導體領域已建立了顯著的競爭優勢。在關鍵子系統及核心零部件自主研發上，於往績記錄期間，我們已立項並竣工多個關鍵模組自研項目，包括大功率精密激光對準系統開發、主動聚焦系統及關鍵模塊開發、深度學習靶標識別、平穩移動的氣浮平台、多鏡頭整合系統開發、高穩定性全自動化線等，基本完成公司關鍵子系統、核心零部件的自主可控，在此基礎上不斷探索行業技術前沿。

我們重視創新技術及解決方案的投入。作為國家級高新技術企業，我們積極投身國家科技發展戰略，先後承擔並圓滿完成了多項國家、省、市級科研項目，包括6代線平板顯示曝光機項目、90nm-65nm製版光刻設備研製、晶圓級封裝(WLP)直寫光刻設備產業化項目等。自2021年於上海證券交易所科創板上市以來，公司主動佈局產學研項目，進一步集聚高校、企業等各方資源，目前已與中國頂尖學術機構簽訂展開多達10項課題合作，覆蓋用於微納製造的精密環控系統、光機熱耦合、微透鏡陣列、高精度位移傳感器、AI智能預警、計算機輔助芯片圖形化等各個領域，不斷拓寬直寫光刻核心技術護城河。我們相信該等合作已不斷拓寬我們在微納光刻核心技術的護城河，並加強了我們的能力及競爭力。於業績記錄期內，我們的研發總投入已達到人民幣131.2百萬元。

根據灼識諮詢的資料，隨著公司全球化戰略的深入推進，以及對國產品牌光刻設備的需求不斷上升，我們已在PCB與半導體領域的核心技術方面具有全球競爭力。例如，在阻焊領域我司的NEX機型，多波長技術成熟應用，適用於各色阻焊油墨。該設備支持最小阻焊橋為40  $\mu\text{m}$ ，開窗為60  $\mu\text{m}$ ，生產效率可達每小時300塊面板。這為多層電路板、高密度互連(HDI)電路板、剛性柔性電路板及柔性電路板提供了高產能、高精度、精細窗口及小側蝕

## 業 務

的解決方案。針對高階HDI和IC載板領域，量產的MAS6P系列具備全球業界領先的二次成像技術及微米級對位精度，一次掃描成像最大寬幅達24.5英寸，可適配高密度互聯結構的製造工藝，連線產出至高可達120片／小時。在12英寸／8英寸集成電路先進封裝領域，我們推出的WLP2000機型具備Die shift智能補償、RDL智能佈線、實時自動聚焦、邊緣曝光WEE/WEP、背部對準功能，套刻精度達到 $\pm 0.6 \mu\text{m}$ ，在RDL、Bumping、TSV等制程工藝中優勢明顯，亦在全球範圍內具有顯著技術優勢。而應用於MEMS／功率器件／生物芯片微納光刻加工的研究與生產場景，主推的MLC600/900機型體積小、性價比高，以超精細加工能力見長，其最小線寬精度低於600nm，能滿足微納尺度結構的光刻需求。

### 全場景且不斷拓展的設備產品組合

自成立以來，我們深耕微納直寫光刻設備行業，始終堅持以技術為驅動、市場為導向，構建起全場景且不斷拓展的產品組合。我們全面的產品組合確立了「半導體領域+印製電路板領域」雙輪驅動的產品佈局，同時不斷拓展以覆蓋更多半導體應用(如IC載板、先進封裝、新型顯示及其他新興應用)以及更高端的印製電路板。我們致力於以兼容更先進制程的光刻設備替代成熟制程中使用的光刻設備，並在先進制程及下一代制程中，為消費電子、新能源汽車及AI服務器等下游領域的客戶提供國產替代方案以取代外國競爭對手的進口微納光刻設備。

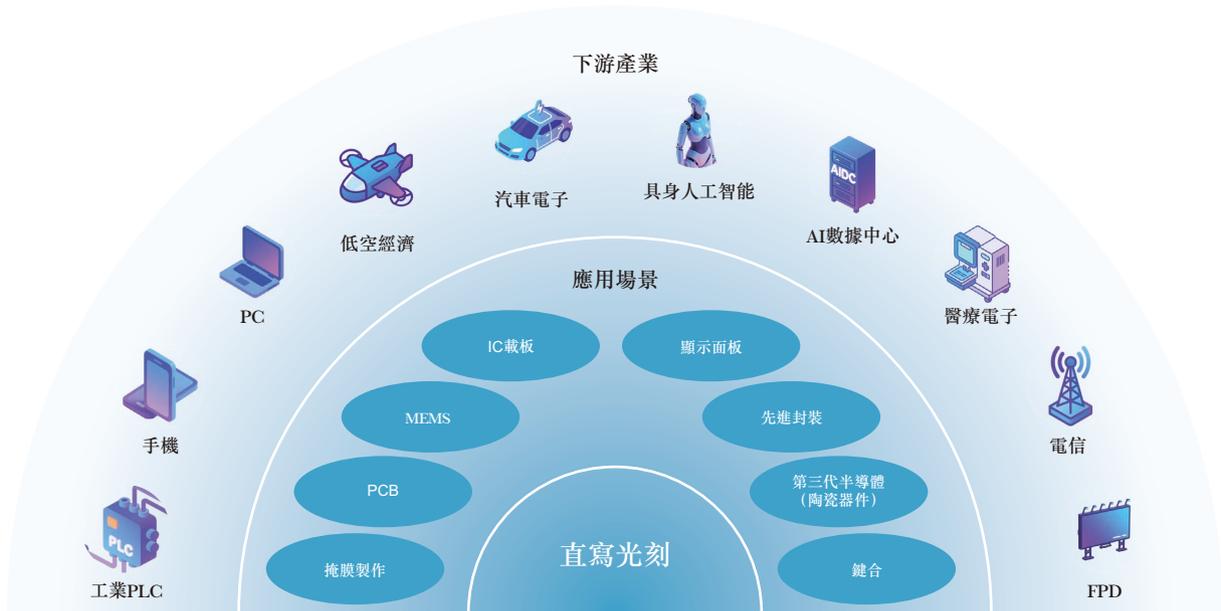
我們的產品組合開發主要集中於以下方面：

- **性能攻堅：**專注於提升我們光刻設備的穩定性、效率及精度，以保持行業發展的領先地位。例如，半導體領域WLP機型支持先進封裝2.5D/3D結構、CoWoS(晶圓上晶片封裝)、SoW(晶圓級系統)等先進工藝制程。
- **需求定製：**聚焦客戶生產痛點，開發出小型化、高穩定性、智能化設備在市場中快速落地，如小型化設備適配中小客戶場地需求，高穩定性、智能化設備旨在助力頭部廠商提升良率，成為支撐海外市場突破的重要支點。
- **前瞻佈局：**緊跟下游產業擴張節奏，提前完成技術儲備與產品開發。在PCB領域，我們已成功推出IC載板阻焊、CO<sub>2</sub>激光鑽孔等新產品。在半導體領域，我們的設備契合客戶先進封裝產能擴張需求，同時適用於玻璃芯基板、玻璃基板等先進發展趨勢。同時，根據灼識諮詢的資料，我們的顯示面板製造設備產品亦處於行業應用前沿，為未來拓展先進封裝(如鍵合)的新興平台化場景奠定堅實基礎。

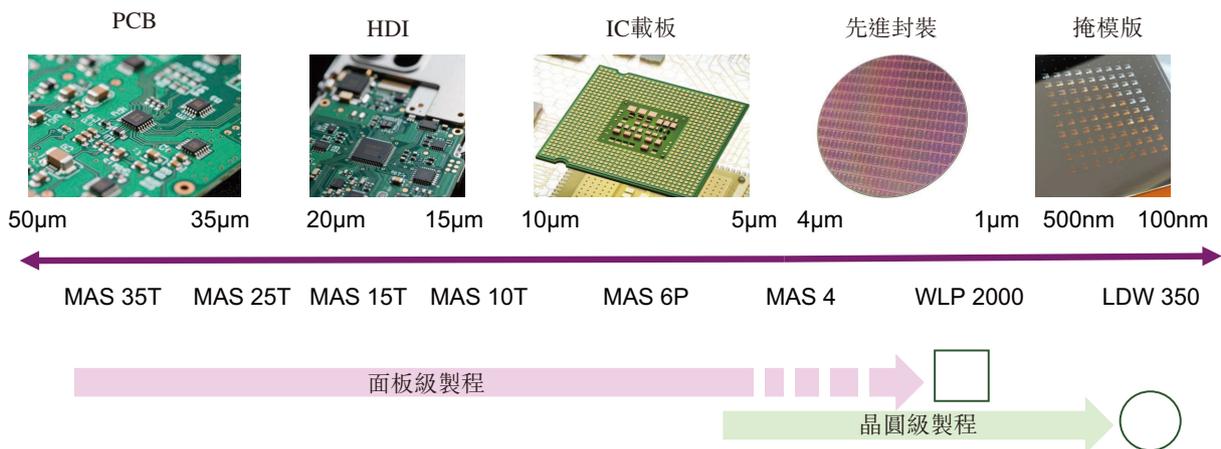
## 業 務

基於上文所述，我們已建立全面的直寫光刻設備產品組合，廣泛覆蓋(i)掩模製作、PCB及MEMS等傳統應用；(ii) IC載板、顯示面板、先進封裝及第三代半導體(陶瓷器件)等先進應用；及(iii)鍵合等新興交叉應用。我們的豐富產品佈局既能覆蓋了行業內頭部客戶的規模化生產需求，也能滿足不同細分領域中眾多客戶的差異化訴求。

下圖展示了我們直寫光刻產品的應用場景以及所覆蓋的下游產業。



我們的產品以直寫光刻技術為核心，能夠覆蓋從面板級製程到晶圓級製程的不同基板尺寸，如下圖所示。



## 業 務

隨著我們的核心技術向半導體相關縱深領域滲透，以及全球化研發資源的整合，作為覆蓋多領域的微納製造解決方案，我們的產品應用場景將進一步拓寬，並將不斷鞏固我們在直寫光刻領域的先發優勢。

### 「標準化生產」與「定製化生產」雙模式並行，造就全球領先的模塊化製造能力

基於多年在技術研發及製造設施方面的持續投入，以及在供應鏈和生產工藝方面累積的專業知識，我們已開發出模塊化生產能力，將我們的設備產品分解為獨立且經精心界定的模塊，然後再集成開發為成品。該等模塊既可以是標準化的，可用於集成至不同的光刻設備型號，亦可根據特定客戶的獨特規格進行高度定製化設計。根據特定客戶要求的定製化水平，我們可調整用於不同設備型號的標準化和定製化模塊的數量。

該等模塊化生產能力使我們能夠在大規模量產的同時，交付高品質、高效率與高穩定性的設備產品，並滿足行業龍頭客戶的多元化需求。標準化模塊有效保障了產品質量與高效的產出能力。在標準化模塊模型確保品質與產能的基礎上，我們通過定製化模型，精準契合不同客戶的差異化需求，尤其是我們半導體設備產品的不同類型客戶。例如，IC載板及先進封裝的客戶對光刻的要求可能有重大差異。在先進封裝領域，針對倒裝芯片、扇入型晶圓級封裝等多種封裝形式，我們為多光學引擎並行掃描、自動套刻、背面對準、智能糾偏提供定製化模塊，滿足RDL、Bumping、TSV等製程的專業需求。憑藉定製化生產能力，我們已成功進入多家國內頭部封測企業的供應鏈，並為其提供契合大尺寸晶片封裝需求的專用設備。

我們的模塊化生產能力結合了標準化及定製化模塊的優勢，在生產效率、成本控制與基於客戶需求的定製化之間實現了有效平衡。我們的模塊化能力旨在避免我們進行從零開始設計產品的過度定製；反之，我們審慎評估客戶的定製化需求，並在可行範圍內納入標準化模塊，以確保在滿足客戶定製化需求的同時，最大限度地提高生產效率，並確保準時交付、成本效益及質量一致性。例如，憑藉該等模塊化能力，我們MAS及NEX系列PCB直接成像設備產品的生產交付週期已縮短至2025年的最快約四週。

經過多年深耕，我們形成了覆蓋整個行業供應鏈的深度合作網絡，有助於穩定原材料供應。除規避原材料供應短缺外，與供應商的密切合作，更能根據材料與組件的特性，及

## 業 務

時優化製造工藝，從而持續提升產品品質與一致性。因此，我們的供應鏈協同能力有助於保障原材料的供應及與生產流程與進度的適配性以及最終產品質量，並讓我們能持續滿足全球客戶在產能穩定性與持續性方面的高標準要求。

### 我們作為核心裝備製造商專注與頭部客戶群建立長期穩定合作關係

在不斷推出和迭代優異的核心設備產品和打造卓越的品牌知名度的基礎上，我們培育了專業技術服務團隊，憑藉為PCB、半導體及其他相關電子信息產業價值鏈上的客戶提供迅速、及時且高效的技術支持與服務，我們的客戶服務團隊在維持客戶忠誠度方面已形成競爭優勢。通過多年的優質產品開發、市場開拓和客戶關係維護，我們建立了完善的客戶服務網絡，在PCB及半導體領域內積累了豐富的客戶資源。

於往績記錄期間，公司PCB直接成像設備銷售收入逐年增長，在PCB直接成像設備行業市場佔有率不斷提升。我們已與行業龍頭企業建立長期穩定的業務合作關係：截至2025年12月31日，我們於全球擁有逾600家客戶，根據灼識諮詢的資料，截至2025年6月30日，客戶涵蓋全球全部十大PCB製造商及全球百強PCB製造商中的七成；我們已在先進封裝領域建立穩定的客戶基數，並於往績記錄期間及截至最後實際可行日期服務16名客戶。我們的設備產品已廣泛應用於多個領域，包括掩膜版製造、PCB、MEMS、IC載板、第三代半導體(陶瓷器件)及顯示面板。長期、穩定的合作夥伴關係構成了我們優質的高粘性客戶資源，為我們後續業務的持續拓展奠定了堅實的基礎。

### 具遠見及專業的管理團隊，擁有豐富行業經驗及強大執行能力，以及推動持續創新的核心科學家團隊

經過多年在微納直寫光刻設備行業的持續、穩定經驗，我們已建立起一支行業經驗豐富、結構合理、技術精湛、團結合作、專業及執行能力超強的管理團隊，保障了公司運營的穩定和管理決策的科學規範。

我們亦始終把人才發展和培養作為長期戰略的核心部分。作為我們技術創新的基礎，我們高素質、經驗豐富的核心科學團隊成員擁有平均逾10年的半導體設備開發經驗，以及來自多家跨國公司的專業經驗。截至2025年12月31日，我們擁有281名研發人員，佔我們員工總數三分之一以上。我們的研發人員專業覆蓋面廣，涵蓋光學、精密機械、圖形處理、機器視覺、深度學習、測控技術與儀器等專業領域。

---

## 業 務

---

### 我們的策略

#### 持續投資關鍵技術，保持技術的全球領先優勢，持續引領前沿技術的探索及產業化

對研發的持續投資是我們產品創新及保持競爭優勢的基石，我們擬持續增加直寫光刻相關的各關鍵領域的研發支出，專注於高端PCB領域及先進封裝、IC載板等半導體細分領域產品的研究和開發。這將進一步加強我們在全球直寫光刻設備領域的技術能力和產業化能力的領先優勢，使我們能夠更好地應對不斷變化的市場需求，持續提升市場競爭力。

#### 深化與頭部客戶的合作

我們將持續聚焦行業頭部企業，通過深度綁定大客戶，打造長期穩定的合作關係。我們計劃進一步憑藉自身技術優勢與產品競爭力，為大客戶定製專屬解決方案，滿足其多樣化、專業化需求。在未來與主要客戶的合作過程中，我們將一如既往地保持及時響應客戶反饋，持續優化產品與服務。我們相信，該等措施有助於提升客戶粘性與滿意度，並借助大客戶的行業影響力與市場輻射力，強化品牌效應，拓展市場份額，鞏固行業領先地位。

#### 戰略性擴張和優化資源配置，加深全球化佈局和品牌建設

我們計劃持續推進構建全球化網絡，以中國內地市場為核心，重點突破東南亞、日韓等區域。我們旨在該等主要市場建立標準化、專業化服務能力和全球化製造、研發及服務體系，以確保並進一步提升我們對當地主要客戶的價值貢獻的質量及響應速度。憑藉我們的技術、產品質量及客戶服務能力優勢，我們將可擴大海外市場的客戶群、擴大海外市場份額，並不斷加深國際化佈局和全球化的品牌形象建設。

#### 通過產業鏈整合及戰略併購以促進增長

為補充我們的有機增長策略，我們將繼續有選擇性地尋求戰略投資，包括進行可增強我們在產業價值鏈及我們目前服務或可能涉足的各個上下游相關市場的能力的投資及收購，以及擴展我們的用戶群或擴展我們的產品及服務。

#### 持續吸引和留住全球人才，不斷提升團隊凝聚力與創造力

我們始終高度重視全球人才隊伍的培養和建設，積極吸引來自全球的優秀人才，驅動創新發展，提升競爭力。我們將繼續加大對人才戰略的投入，積極拓展招聘渠道，重點吸

## 業 務

納半導體、AI領域領軍人才，建立多元化培養體系。我們將繼續培養鼓勵員工積極性和創造性的企業文化，從而增強我們的技術能力，推動創新。同時，我們將繼續實施核心團隊股權激勵機制，不斷提升人均效能及員工忠誠度。

### 我們的產品及服務

本公司專業從事以微納直寫光刻技術為核心的直接成像設備及直寫光刻設備的研發、生產及銷售。本公司的主要產品包括(i) PCB直接成像設備及自動線系統；(ii)半導體直寫光刻設備及自動線系統；及(iii)上述產品的全面售後維護及支持服務。我們致力於在產品交付的任何地方提供本地化的現場支援，從而確保我們的服務範圍有效延伸至客戶的營運場所。憑藉在全球直寫光刻設備行業逾10年的專注經驗，我們不斷研發PCB及半導體設備的生產技術工藝。截至2025年12月31日，我們已為逾600家客戶提供近100種類型的PCB直接成像設備和半導體直寫光刻設備，根據灼識諮詢的資料，截至2025年6月30日，客戶涵蓋全球全部十大PCB製造商及全球百強PCB製造商中的七成。根據灼識諮詢的資料，按2024年的營業收入計，我們是全球最大的PCB直接成像設備供應商，市場份額為15.0%。憑藉我們廣泛的產品組合、先進的技術及雄厚的生產實力，本公司能夠迅速適應不斷演變的行業趨勢，並滿足客戶的多元化需求。

下圖載列本公司主要PCB直接成像設備及自動線系統產品主要類型的示意圖：

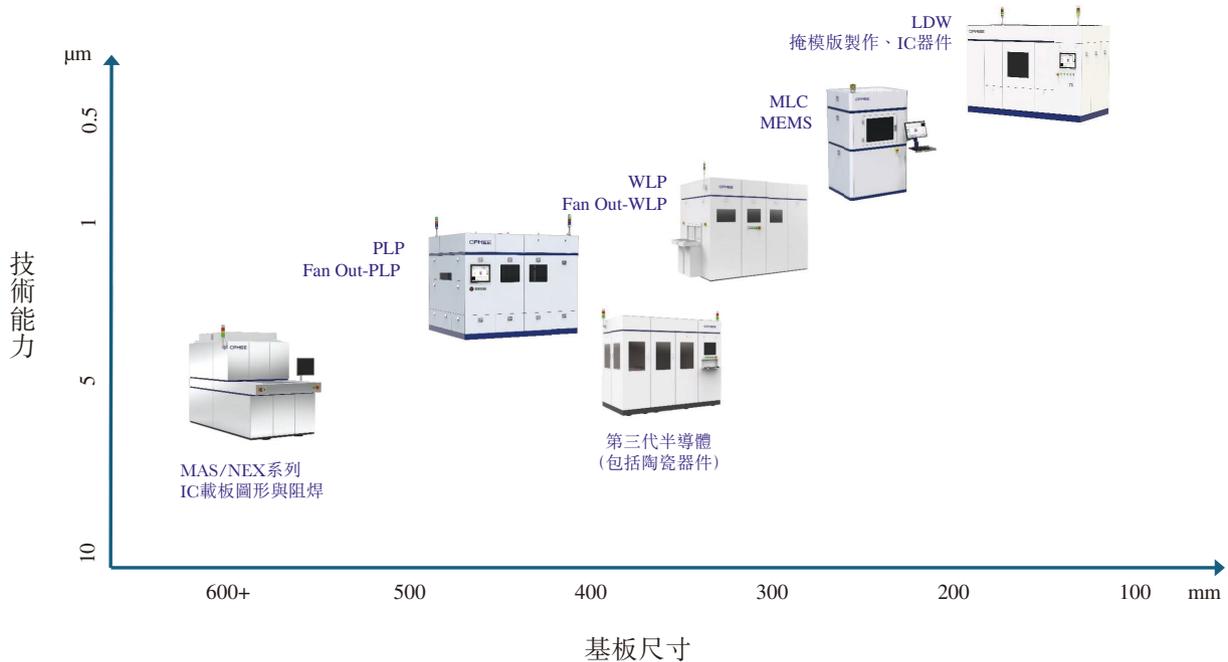


## 業 務

下表載列有關本公司主要PCB直接成像設備及自動線系統產品的主要特點、技術優勢、主要工藝步驟、應用場景及產品系列的若干詳情：

| 主要特點  | 技術優勢  | 關鍵工藝步驟  | 應用場景  | 產品系列   |
|---|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>支持4<math>\mu</math>m的最小線寬</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>無需菲林掩膜版，減少缺陷</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>圖形層及阻焊層光刻</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>精細高密度互聯HDI版</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAS系列</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>高產能及對位精度</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>可實現高密度、精細線路的PCB製造</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>自動化物料處理</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>軟板及軟硬結合板</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>FAST系列</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>無需掩膜版的數字光刻</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>靈活適應各種基板類型及尺寸</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>在線檢測及可追溯性</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>多層板製造</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>RTR系列</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>模塊化自動集成</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>與MES的實時數據整合</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>面板級生產</li> </ul>     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>NEX系列</li> </ul>  |

下圖載列本公司主要半導體直寫光刻設備及自動線系統產品主要類型的示意圖：



## 業 務

下表載列有關本公司主要半導體直寫光刻設備及自動線系統產品的主要特點、技術優勢、主要工藝步驟、應用場景及產品系列的若干詳情：

| 主要特點   | 技術優勢  | 關鍵工藝步驟  | 應用場景   | 產品系列  |
|--|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>支持350nm的最小線寬</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>用於先進製程節點的直寫(例如130nm至90nm)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>IC掩膜版及芯片光刻</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>IC掩膜版製造</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>LDW系列</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>多光學引擎並行掃描</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>用於IC掩膜版、MEMS、OLED的高解析度圖形化</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>晶圓級及面板級封裝</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>高端IC載板</li> <li>先進半導體封裝(WLP、PLP)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>MLC系列</li> <li>WLP系列</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>先進的對準及補償算法</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>實時工藝監控及反饋</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Micro/mini LED及OLED顯示面板光刻</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>MEMS及生物芯片生產</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>PLP系列</li> <li>WA/WB系列</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>兼容晶圓級及面板級封裝</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>與MES無縫連接</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>自動化基板傳輸及檢測</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Micro/mini LED及OLED顯示面板製造</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>MLF系列</li> <li>RTR DE系列</li> <li>MAS系列</li> <li>NEX系列</li> <li>EE系列</li> <li>TE系列</li> </ul> |

下表載列本公司產品於所示年度按性質劃分的營業收入、銷量及平均售價(不含稅)詳情：

|                      | 截至12月31日止年度    |            |                |                |            |                |                  |            |                |
|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|
|                      | 2023年          |            |                | 2024年          |            |                | 2025年            |            |                |
|                      | 營業收入           | 銷量         | 平均售價           | 營業收入           | 銷量         | 平均售價           | 營業收入             | 銷量         | 平均售價           |
|                      | 人民幣            |            | 人民幣            | 人民幣            |            | 人民幣            | 人民幣              |            | 人民幣            |
|                      | 千元             | 台          | 千元/台           | 千元             | 台          | 千元/台           | 千元               | 台          | 千元/台           |
| PCB直接成像設備及自動線系統..... | 589,811        | 280        | 2,106.5        | 772,887        | 378        | 2,044.7        | 1,079,928        | 475        | 2,273.5        |
| 半導體直寫光刻設備及自動線系統      | 188,247        | 54         | 3,486.1        | 109,843        | 27         | 4,068.3        | 233,419          | 61         | 3,826.5        |
| 總計/整體.....           | <u>778,058</u> | <u>334</u> | <u>2,329.5</u> | <u>882,730</u> | <u>405</u> | <u>2,179.6</u> | <u>1,313,347</u> | <u>536</u> | <u>2,450.3</u> |

## 業 務

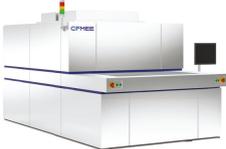
### PCB直接成像設備及自動線系統

本公司的PCB直接成像設備及自動線系統主要用於PCB製造的光刻工藝，特別是用於圖形層及阻焊層的光刻。光刻工藝乃屬PCB製造的基本步驟，涉及通過精確的光學圖形化及後續顯影將設計的電路圖形轉移到PCB基板上。傳統上，光刻工藝依賴於菲林掩膜版。然而，本公司的直接成像技術無需掩膜版即可實現數字光刻，從而簡化生產並降低與菲林材料相關的缺陷風險。

本公司的PCB直接成像設備支持4 μm的最小線寬，可滿足如HDI板等廣泛PCB應用的技術要求。自成立以來，為應對不斷變化的行業趨勢，我們已開發一系列PCB直接成像系統。本公司的設備在最小線寬、產能及對位精度方面可達致具競爭力的水平。其中，MAS 4型號可實現4 μm的最小線寬，滿足IC載板製造的嚴格要求。MAS 35T獨立系統在最小線寬為35 μm及對位精度為±12 μm的情況下，產能可達每小時480片；而MAS 15T獨立系統在最小線寬為15 μm及對位精度為±8 μm的情況下，產能可達每小時360片。

此外，本公司的直接成像技術無需使用掩膜版，可實現全數字化的光刻工藝。此舉不僅提升了生產效率，亦提高了產品質量及一致性，對高密度及精細線路的PCB應用而言尤為如此。

下表載列截至2025年12月31日本公司主要PCB直接成像設備的若干詳情：

| 產品系列            | 產品圖示  | 特點  | 應用場景                   | 指導價格<br>範圍<br><br>(人民幣<br>千元/台) |
|-----------------|---|---|------------------------|---------------------------------|
| MAS系列 . . . . . |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>領先的圖形光刻直接成像解決方案</li> <li>高解析度成像，實現精細線路優異的線寬一致性及邊緣粗糙度</li> <li>適用於軟板、軟硬結合板、HDI及多層板</li> </ul> | FPC、軟硬結合板、HDI及多層板的圖形光刻 | 2,000–4,800                     |
| NEX系列 . . . . . |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>新一代高性能阻焊直接成像系統</li> <li>大功率曝光光源</li> <li>用於阻焊製程的精密成像及定位系統</li> </ul>                         | 各類PCB的阻焊光刻             | 2,300–4,800                     |

## 業 務

| 產品系列        | 產品圖示  | 特點   | 應用場景             | 指導價格<br>範圍<br><br>(人民幣<br>千元/台) |
|-------------|---|--|------------------|---------------------------------|
| RTR系列.....  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>卷對卷直接成像系統</li> <li>集成高精度成像及卷對卷處理</li> <li>為連續性柔性PCB生產而設計</li> </ul>   | FPC光刻，卷對卷柔性PCB製造 | 3,800–8,000                     |
| FAST系列..... |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>高產能、佔地面積小</li> <li>為大尺寸面板印製電路板生產優化</li> <li>為高良率印製電路板製造而設計</li> </ul> | 大尺寸面板印製電路板製造     | 1,150–2,700                     |

此外，我們已開發一系列激光鑽孔設備，包括MUD系列(紫外激光鑽孔系統)及MCD系列(二氧化碳激光鑽孔系統)，專為HDI及FPC應用的通孔成形而設計，以滿足先進PCB製造中對細間距及高密度互連日益增長的需求。該等系統能夠進行高精度激光鑽孔，最小孔徑為35  $\mu\text{m}$ ，並具備實時能量監控功能，以確保工藝穩定性及質量。

### 半導體直寫光刻設備及自動線系統

本公司的半導體直寫光刻設備及自動線系統主要用於IC掩膜版製造、IC載板、先進封裝以及micro/mini LED及OLED顯示面板生產的光刻工藝環節。與PCB直接成像設備相比，本公司的半導體直寫光刻設備支持350nm的更窄最小線寬，旨在滿足高端半導體及顯示設備生產工藝的嚴格要求。

與PCB直接成像設備針對微米級的圖形及阻焊光刻進行優化不同，本公司的半導體直寫光刻設備專為亞微米級精度而設計，適用於廣泛的半導體及顯示應用。該等產品能夠支持130nm至90nm制程節點的掩膜版製作、晶圓級及面板級封裝、MEMS以及micro/mini LED及OLED面板製造。

於2023年、2024年及2025年，我們自半導體直寫光刻設備及解決方案錄得的營業收入分別為人民幣188.2百萬元、人民幣109.8百萬元及人民幣233.4百萬元，分別佔我們各年度營業總收入的22.7%、11.5%及16.6%。

## 業 務

下表載列截至2025年12月31日本公司主要半導體直寫光刻設備的若干詳情：

| 產品系列        | 產品圖示  | 特點   | 應用場景  | 指導價格<br>範圍<br><br>(人民幣<br>千元/台) |
|-------------|---|--|---|---------------------------------|
| LDW系列 ..... |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最小線寬優於350nm</li> <li>• 適用於IC掩模版、IC芯片、MEMS、生物芯片的直寫光刻</li> </ul>              | IC掩模版製版、<br>IC載板、<br>MEMS、生物<br>芯片                    | 7,000–12,000                    |
| WLP系列.....  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 多光學引擎並行掃瞄</li> <li>• 自動套刻、背部對準、智能糾偏</li> <li>• 用於12吋/8吋晶圓的先進封裝</li> </ul>   | 倒裝芯片、扇入<br>型晶圓級封<br>裝、扇外型<br>晶圓級封裝、<br>2.5D/3D封裝      | 10,000–25,000                   |
| PLP系列 ..... |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 多光學引擎並行掃瞄</li> <li>• 自動尋邊對準、自動追焦、智能糾偏</li> <li>• 支持覆銅板、複合材料、玻璃基板</li> </ul> | 面板級封裝：<br>FC CSP、FC<br>BGA、扇入<br>型/扇外型<br>PLP、2.5D/3D | 7,000–10,000                    |
| MLF系列.....  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 結構緊湊，景深大、產能高</li> <li>• 可靈活配置</li> <li>• 對乾膜和光刻膠均有良好的工藝適應性</li> </ul>       | 硅基/碳化硅<br>功率器件、<br>MEMS、陶瓷<br>封裝                      | 2,000–5,500                     |
| MLC系列 ..... |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 精巧型設計</li> <li>• 最小線寬優於600nm</li> <li>• 適用於研究與生產</li> </ul>                 | IC載板、掩模<br>版、MEMS、<br>生物芯片                            | 1,000–3,000                     |
| FPD解決方案...  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最小解析度優於700nm</li> <li>• 為Micro/mini LED及OLED面板光刻工藝而設計</li> </ul>            | Micro/mini LED及<br>OLED顯示面板<br>製造                     | 35,000                          |

## 業 務

| 產品系列     | 產品圖示  | 特點  | 應用場景 | 指導價格<br>範圍                   |
|----------|---|---|------|------------------------------|
| IC載板解決方案 |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 最小解析優於4 μm</li><li>• 用於IC載板的線路和阻焊的全製程曝光</li></ul> | IC載板 | (人民幣<br>千元/台)<br>4,000–6,500 |

### 設備維保服務

我們亦提供全面的設備維保服務及其他增值解決方案，以在產品的整個生命週期為客戶提供支持。我們的維保服務旨在確保設備的穩定可靠運行，最大限度地減少停機時間，並幫助客戶實現投資回報最大化。

我們的設備維保服務包括定期預防性維護、現場故障排除及維修、備件供應、設備升級及技術支持。我們擁有一支在機械、電氣及光學系統方面擁有豐富經驗的專業服務團隊，使我們能夠迅速響應客戶需求並提供高質量的服務解決方案。除定期維護外，我們亦提供緊急維修服務，以解決意外的設備問題並最大限度地減少生產中斷。

於2023年、2024年及2025年，我們自設備維保服務錄得的營業收入分別為人民幣44.4百萬元、人民幣64.0百萬元、及人民幣84.4百萬元，分別佔我們各年度營業總收入的5.4%、6.7%及6.0%。

### 研發

我們致力於技術創新，此乃屬提升我們的核心競爭力、推動可持續增長及為客戶創造價值的基礎。我們已建立全面的研發體系及一體化產品開發管理體系，以確保我們的研發活動最終能實現商業成功並達成業務目標。我們的研發管理部、產品管理部及產品開發項目團隊負責研發項目的整體管理，包括規劃、項目立項、開發及生命週期管理。於往績記錄期間，我們持續優化一體化產品開發管理體系及研發流程。通過推動平台化產品開發及矩陣式管理模式，我們提升了資源利用率，提高了新產品發佈的成功率，並鞏固了我們的技術及產品競爭力，以支持業務的可持續增長。

我們已建立一個結合經驗豐富的行業專家與年輕技術專才的人才架構，營造一個創新及協作的環境。截至2025年12月31日，我們的研發團隊由281名僱員組成，約佔我們員工總數的三分之一以上。在特定應用場景及客戶需求的驅動下，我們的研發團隊專注於通過工

## 業 務

藝創新、設備升級及技術優化來解決行業痛點。我們堅持系統化的研發管理方法，不斷完善人員、設備、材料、方法、環境及測量標準。憑藉我們積累的專業知識及資源，我們能夠快速響應市場趨勢及技術進步，確保我們的產品及解決方案保持行業領先地位。

### 研發流程

我們已建立結構化及標準化的研發流程，以確保我們的產品開發與市場需求、技術趨勢及我們的戰略目標緊密結合。該流程旨在管理研發項目的整個生命週期（從項目立項到量產），確保每個階段的嚴格質量控制、風險管理及高效資源分配。我們的研發項目通常通過以下六個關鍵階段進行：

- **項目立項及機會評估**：我們的產品開發團隊（「PDT」）對市場及客戶需求、產品競爭力、技術趨勢及投入產出評估進行全面的研究及分析。根據該分析，我們提出新研發項目並制定初步產品業務計劃。
- **概念分析及可行性研究**：項目獲批後，我們的產品開發團隊對產品需求進行系統分析，開展技術可行性研究，並制定執行策略。我們的產品業務計劃隨後會被完善和正式化，為下一開發階段提供清晰的框架。
- **細節設計及系統設計**：概念分析及可行性研究階段結束後，我們的產品開發團隊組織系統級設計，界定產品規劃基線，並為各職能及學科制定詳細的行動計劃。
- **產品開發及跨職能整合**：詳細設計獲批後，我們的研發團隊設計及整合產品以滿足規格，市場、製造、質量及服務職能部門積極參與，以確保各領域的準備就緒。原型開發及內部驗證完成後，項目進入核實階段。
- **核實與小批量試產**：我們組織產品的現場客戶驗證，並進行小批量試產，以核實可製造性及可服務性。此階段確保產品滿足功能需求，具備量產能力，並為市場成功做好定位。
- **產品發佈及市場推出**：成功核實及小批量試產後，我們進入發佈階段，正式推出產品並開始大規模市場銷售。

### 我們的主要技術及研發成果

我們的核心技術成果包括(i)先進的光刻紫外光源與曝光引擎技術、(ii)高精度、高速對準及自動對焦技術，(iii)高速、實時、高精度圖形處理技術，及(iv)高可靠性系統監測及自動化標定技術。我們相信，該等技術成果不僅支持我們現有的產品供應，亦使我們能夠抓住先進製造及新一代應用中的新興機遇。

## 業 務

### **先進的光刻紫外光源與曝光引擎技術**

我們已研發先進的光刻紫外光源與曝光引擎技術，為直寫光刻設備的解析度及產能奠定堅實基礎。我們在高功率及高穩定性紫外光源模塊方面取得了突破，覆蓋375nm至445nm的波長範圍，支持單波長及多波長組合輸出。該等創新增強與多種光刻膠系統的兼容性，並顯著提高生產一致性。憑藉該等光源技術及集成高精度光學系統設計，我們已為不同PCB產品系列(主要為阻焊層及圖形系列)開發專用曝光引擎，實現了包括高功率耐受性、低失真、高解析度及大畫幅二次成像在內的關鍵特性。

### **高精度、高速對準及自動對焦技術**

我們開發了高精度、高速對準及自動對焦技術，為直寫光刻設備的精準高效運行及多層套準提供可靠保障。該技術以精密工作站為支撐，為高精度對準及運動控制提供穩定而精確的機械基礎。該技術集成了高精度基準點識別與定位、實時自動對焦及高精度多軸協同運動控制等關鍵功能。在基準點識別與定位方面，我們已克服傳統算法的局限性，實現了亞微米級( $3\sigma$ )識別精度及卓越的穩定性，有效避免了圖案錯位及變形。在自動對焦方面，我們集成了高靈敏度測距及快速響應致動器，可自動實時補償由熱漂移、振動及基板變形引起的離焦，確保高速掃描過程中的最佳焦距，從而實現均勻的線寬(差異小於 $\pm 10\%$ )及穩定的成像。在運動控制方面，我們的精密平台採用高精度多軸協同運動控制技術，確保平穩運動及納米級定位精度，滿足數十納米以內重複精度的嚴苛要求。

### **高速、實時、高精度圖形處理技術**

我們開發了高速、實時、高精度圖形處理技術，為直寫光刻設備實現「數字掩膜版」功能提供核心支撐。我們的圖形處理平台建基於強大的數據鏈路基礎設施，可實現高吞吐量及低延遲的數據傳輸，以支持將大量矢量數據實時轉換為光柵數據。為滿足我們客戶的不同應用需求，我們開發了一整套全面的圖形算法及補償技術，包括線性及非線性圖案轉換、圖案補償、無縫拼接、納米級鏡頭畸變校正、動態多鏡頭線寬一致性以及晶粒偏移校正，確保我們的設備在各種複雜應用場景中保持核心競爭力。

### **高可靠性系統監測及自動化標定技術**

我們開發了高可靠性系統監測及自動化標定技術，旨在幫助客戶提高生產效率並降低營運成本。在設備運行期間，我們通過關鍵硬件模塊狀態反饋、軟件日誌收集及環境控制系統進行多維度系統監測。基於該等系統監測方法，我們可收集及分析設備運行數據，並

---

## 業 務

---

在偵測到異常趨勢時提供預警，幫助客戶提前識別潛在問題。在系統監測的基礎上，我們亦開發了基於自研算法的自動化標定技術，可在60秒內無需人工干預，自動完成光學、平台、對準、環境控制及數據鏈路子系統間的空間關係標定。

除內部研發工作外，我們亦積極與核心客戶及領先學術機構開展聯合研發項目。對於核心客戶，我們合作進行現有設備的定製化增強，並共同開發全新產品以應對新興的行業需求。該等聯合開發項目通常受合作協議規管，其中明確界定了知識產權所有權及其他關鍵條款。我們亦利用大學及研究機構的資源來支持我們的產品創新，並訂立正式協議以確保知識產權的妥善分配。該等合作使我們能夠始終處於技術進步的前沿，並提供與客戶要求及行業趨勢緊密結合的解決方案。

### 我們的生產

根據產品特性及市場情況，我們採用模組化製造方式，該模式結合了針對大批量、穩定需求產品的標準化生產，以及針對高端、戰略性或技術要求嚴苛項目的定製化生產。該方法使我們能夠在規模及效率優勢與服務具有獨特技術或應用需求的客戶所需的靈活性之間取得平衡。

#### 標準化生產模塊

我們的標準化生產模塊著重產品品質與生產效率。我們根據已確認的客戶訂單及市場需求預測來制定生產計劃。對於需求穩定、銷量大的產品，我們維持一定水平的在產品庫存，以確保及時的交貨週期，並快速滿足客戶需求。該方法提高了我們的營運效率，並支持我們製造活動的可擴展性。

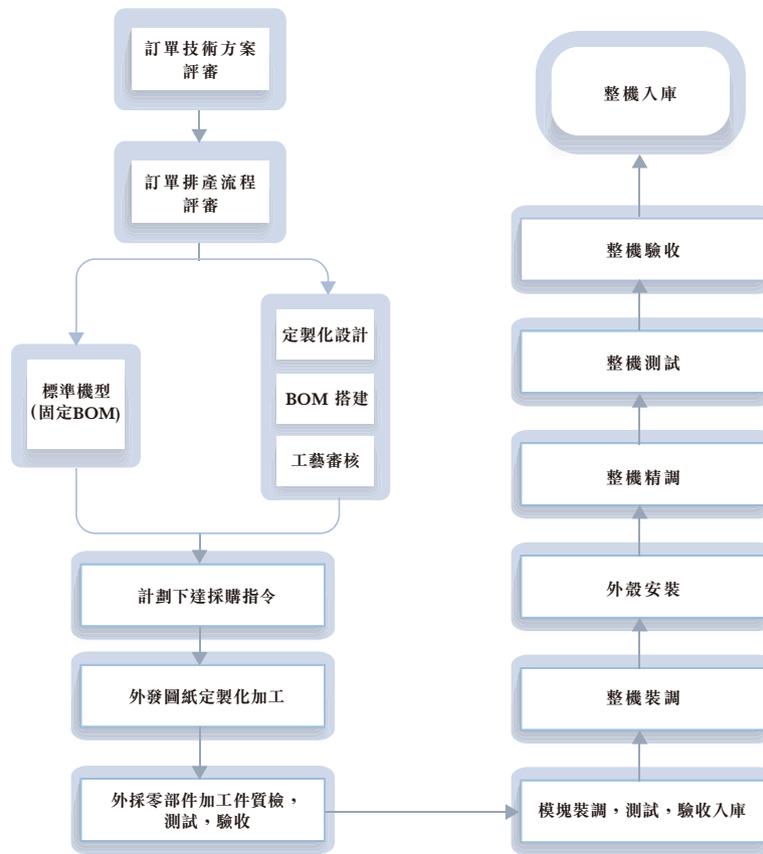
#### 定製化生產模塊

我們的定製化生產模塊主要針對高端戰略客戶或技術要求高的項目，使我們能夠滿足客戶個性化及多樣化的需求，尤其是我們的半導體設備客戶。例如，就先進封裝應用而言，我們提供多光學引擎並行掃描、自動套刻、背面對準及智能糾偏的定製化模塊，以支持多樣化的封裝形式及專門的工藝要求。由於不同細分市場的產品性能及配置要求各不相同，我們亦在定製化生產過程中開發標準化的模塊及解決方案。PCB定製化產品的生產週期一般為12至36週，而半導體定製化產品的生產週期則一般為24至40週，具體取決於訂單的複雜性及技術規格。該以市場為導向的模式使我們能夠提供量身定製的解決方案，以應對獨特的技術挑戰及應用需求，從而鞏固我們與主要客戶的關係，並支持我們在高價值細分市場的地位。

## 業 務

### 生產流程

下表載列本公司主要產品的典型生產流程：



| 步驟 | 生產流程          | 描述  |
|----|---------------|---|
| 1. | 訂單技術方案評審..... | 我們評估客戶的實際需求，推薦並確認合適的設備型號，並與客戶討論及協定相關模塊的定製化及規格，其後敲定技術規格及驗收標準以供後續工作使用 |
| 2. | 訂單排程流程審核..... | 我們根據協定的技術方案，對商務條款及交付計劃進行內部審核，並正式啟動生產。                               |
| 3. | 定製化設計.....    | 我們根據訂單的技術條款及生產計劃，啟動光學、機械、電子及軟件的定製化模塊設計，並按計劃完成設計輸出。                  |

## 業 務

| 步驟  | 生產流程                         | 描述  |
|-----|------------------------------|---|
| 4.  | 物料清單(BOM)編製及流程審核.....        | 我們根據定製化設計編製物料清單，並提交予工藝工程部門進行結構及技術審核與確認。   |
| 5.  | 下達採購訂單.....                  | 我們根據已確認的物料清單，在ERP系統中下達採購訂單，並開始從合格供應商處採購光學、機械及電子組件，確保所有物料符合質量及交付標準。  |
| 6.  | 外包組件(包括定製加工)的質量檢驗、測試及驗收..... | 我們根據需要發出圖紙進行定製加工，並對所有外包組件進行檢驗、測試及驗收。只有合格的物料才能入庫；不合格品將被拒收並退回供應商。   |
| 7.  | 模塊組裝、測試、驗收及入庫.....           | 光學、機械及電子模塊並行組裝及測試： <ul style="list-style-type: none"><li>• 光學模塊：組裝、對準及校準鏡頭、光源及光路，以滿足設計規格。</li><li>• 機械模塊：組裝及校準框架、運動部件及運動系統，以確保穩定性及精度。</li><li>• 電子模塊：組裝及測試控制單元、圖形板及線束，以確保信號完整性及可靠性。</li></ul> 任何不合格模塊都將被返工或淘汰，且不會進入下一步。合格模塊將入庫儲存以供後續集成。 |
| 8.  | 系統集成與調試.....                 | 我們根據生產計劃，將光學、機械及電子模塊集成為整套系統，並進行通電測試及光學參數調試。   |
| 9.  | 外殼安裝.....                    | 我們安裝外部組件及外殼，確保結構完整性、安全性及符合設計要求。   |
| 10. | 總裝微調.....                    | 我們對完全集成的設備進行全面的系統級調試及校準，以確保最佳性能。不合格的系統在進入下一步之前將被退回重新調試或返工。  |

## 業 務

| 步驟  | 生產流程       | 描述   |
|-----|------------|--|
| 11. | 總裝測試 ..... | 我們在額定光源功率下進行穩定性測試，並模擬曝光操作以核實所有設備功能。  |
| 12. | 總裝驗收 ..... | 我們對通過穩定性測試的設備進行全面的質量檢驗，包括外觀、性能、安全性及參數配置。只有通過所有驗收標準的設備方可入庫；不合格設備則退回作進一步調試或返工。 |
| 13. | 總裝入庫 ..... | 合格的成品轉入庫存，為包裝及及時交付給客戶做準備。  |

我們對大規模專用機械的依賴有限，因我們的生產主要集中於機械、電氣及光學組件的精密組裝、校準、集成及穩定性測試。此外，我們的生產流程強調靈活性及適應性，使生產線能夠根據產品規格或客戶要求的變化進行高效的重新配置或調整。此乃通過使用標準化工作站、精密工具及較小規模的組裝設備來實現，而非依賴大型專用機械。我們生產過程中使用的主要設備包括激光干涉儀、光學／電子顯微鏡、定心儀、離線精密測試夾具及層壓機等。於往績記錄期間，我們定期對生產設備進行升級、預防性維護及引進先進技術，以確保我們的生產效率及產品質量。

我們嚴格執行生產工藝標準，並確保設有標準作業程序（「SOP」）以指導整個生產過程的標準化操作。我們已設立工序質量控制點及由自檢、互檢及專檢組成的三級檢驗機制，並在關鍵階段設立質量檢驗站，以全面監控產品質量，並確保最終交付符合客戶要求。請參閱「—質量控制」。

### 生產管理系統

為支持我們的數字化及智能生產舉措，我們已實施一系列生產管理系統，包括生產計劃管理系統、產線任務分配系統及生產調度系統。該等系統可實現採購、生產、供應商協同及客戶關係的集成管理，並提供數據分析以支持決策及資源優化。

- **生產計劃管理系統**：我們利用ERP系統中的物料需求計劃（「MRP」）功能，構建符合我們業務需求的MRP框架。我們以工單為核心驅動，實現供需平衡及自動化生產規劃。我們亦協調物料申領與交付跟蹤，從而提高物料管理效率及準確性。

## 業 務

- **產線任務分配系統**：我們使用該系統整合產品線訂單管理、售後服務及日常運營任務，從而實現標準化項目管理。該系統支持工作流程規劃、任務分配及實時監控。
- **生產排程系統**：我們獲取排程審批信息，並自動分析生產需求及設備參數。該系統生成精確的設備配置清單，並將工藝參數直接推送至車間終端以指導生產。我們亦維護具備版本可追溯性的電子設備檔案，記錄配置變更、維護歷史及性能數據，以支持預防性維護。
- **生產異常處理系統**：我們通過該系統管理異常報告、處理、關閉及問責的全過程。異常表單讓我們能夠快速報告問題、自動協調生產及研發資源、指派負責人員，並確保跟進及關閉。
- **工藝優化系統**：我們已為流程改進建議、審核、任務分配及關閉建立了數字化工作流程。通過將該系統與飛書平台集成，我們可以快速提交改進建議並接收反饋。建議一經批准，系統會指派負責人員、設定截止日期並動態跟蹤進度，從而實現跨部門協作及持續的流程優化。
- **質量管理體系**：我們已在飛書平台上建立質量管理體系，將從物料接收到成品交付的檢驗要求及程序標準化。我們設立工序控制點，監控質量數據，並對異常情況快速響應。我們亦為關鍵物料及產品分配唯一的追溯碼，確保在我們整個供應鏈及生產過程中的全面可追溯性。

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無因設施、設備或系統故障而導致任何重大生產中斷，亦無發生任何重大事故。

### 生產基地

於最後實際可行日期，我們在中國合肥擁有一個生產基地，包括一期及二期。

#### 合肥生產基地

截至2025年12月31日，我們的合肥生產基地(一期)總建築面積約為34,879.8平方米。合肥生產基地(一期)於2021年投產，專門生產高端PCB直接成像設備、晶圓級封裝直接成像光刻設備及FPD設備。

截至2025年12月31日，我們的合肥生產基地(二期)總建築面積約為40,397.9平方米。合肥生產基地(二期)於2025年9月開始初步試運營，專門生產自動線系統、高端PCB直接成像

## 業 務

設備、激光鑽孔設備、晶圓級封裝直接成像光刻設備及平板顯示器設備。於初步試運營階段，截至2025年12月31日，合肥生產基地(二期)已生產48條自動化生產線以支持96台LDI設備。此階段後，我們計劃根據市場需求及客戶訂單開始正式設備生產，並預期該生產基地將進一步提升我們的製造能力及支持我們的長期增長戰略。

下表載列於所示年度我們合肥生產基地(一期)的詳情：

|                      | 截至12月31日止年度             |          |                          |                         |          |                          |                         |          |                          |
|----------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|
|                      | 2023年                   |          |                          | 2024年                   |          |                          | 2025年                   |          |                          |
|                      | 設計<br>產能 <sup>(1)</sup> | 實際<br>產量 | 產能利用<br>率 <sup>(2)</sup> | 設計<br>產能 <sup>(1)</sup> | 實際<br>產量 | 產能利用<br>率 <sup>(2)</sup> | 設計<br>產能 <sup>(1)</sup> | 實際<br>產量 | 產能利用<br>率 <sup>(2)</sup> |
|                      | 台                       | %        | 台                        | %                       | 台        | %                        | 台                       | %        |                          |
| 合肥生產基地<br>(一期) ..... | 270                     | 312      | 116.6                    | 270                     | 465      | 172.2                    | 330                     | 581      | 176.1                    |

(1) 設計產能指一個生產基地可實現的PCB直接成像設備及半導體直寫光刻設備的產量，其計算方法為將我們合肥生產基地(一期)的總生產工位數乘以一年的實際工作天數，再除以每台所需調試天數。於2023年及2024年，我們的合肥生產基地(一期)設計年產能約為270台，此乃根據28個生產工位、每年300個實際工作天數及每台設備需30天調試，並經計及維護、故障或其他延誤後計算。於2025年，繼我們擴充產能後，按相同方法計算，設計年產能約為330台。

(2) 產能利用率按實際產量除以各年度設計產能計算。

我們亦根據我們瓶頸工序的實際產出及並行調試能力評估我們的有效產能，我們認為此更能反映我們在正常營運條件下的可持續製造能力。由於我們的生產涉及多個階段(包括組裝、集成、除錯及最終調試)，總產出主要受瓶頸工序及調試資源的可用性所限制。根據此方法，我們估計我們合肥生產基地(一期)的有效產能約為每年400台。於往績記錄期間，我們合肥生產基地(一期)於2023年、2024年及2025年的有效產能利用率分別為78.0%、116.3%及145.3%。

於往績記錄期間，我們合肥生產基地(一期)的有效產能利用率呈上升趨勢，並超過100%，此乃主要由於我們持續優化工藝流程及加強生產管理，從而大幅減少每台設備所需的平均工時並提升整體營運效率。此外，於該等期間市場對我們產品的需求強勁，帶動訂單量增加及實際產量提高，使我們得以超越原有的設計產能。根據主管機關合肥高新技術產業開發區經濟發展局出具的書面證明，我們的實際產量與備案設計產能的差異主要由於若干生產線的功能調整及設備利用效率提高所致。該證明確認，概無未經授權建設或擴建生產線，亦無任何重大違規或違法行為，且本公司並無被施加限產、停產或行政處罰。誠如我們的中國法律顧問所告知，基於上述證明及中國相關法律法規，我們超出備案設計產能的生產並不構成重大不合規，且我們董事認為，此事預期不會對我們的營運或財務表現構成重大不利影響。

---

## 業 務

---

### 外協生產

我們的生產模式旨在確保質量控制及營運靈活性。核心生產工序，包括關鍵模塊的組裝、物理校準以及系統集成，均由內部完成，以維持嚴格的質量標準。我們從合格供應商網絡採購電子元器件、PCB、光學元件及其他原材料。請參閱「— 供應鏈管理」。

對於若干非核心工序，如PCB焊接及特定子組件裝配，我們可能委聘外部第三方外協廠商。委外決定通常基於成本效益、產能限制或工序的技術複雜性等因素。在此等情況下，我們提供必要的物料及詳細的技術規格，並要求外協廠商遵守我們的產品圖紙、質量標準及工藝流程文件。我們不依賴任何單一供應商，從而降低供應鏈風險。

由於成本優勢或臨時產能限制，我們亦可能外包若干非核心組件或加工步驟。在選擇外協廠商時，我們會考慮一系列因素，包括技術能力、生產能力、產品質量、交付效率、成本競爭力及合作意願。我們進行定期評估、現場檢查及績效審查，以監控彼等對我們質量標準及合同義務的遵守情況，並根據需要提供技術指導及培訓。

我們與外協廠商所訂立協議的主要條款載列如下：

- **產品規格。**協議一般訂明產品名稱、型號、數量、技術規格及交付日期。雙方均須遵守協定的產品質量標準及技術要求。
- **定價、費用及付款。**除非另有約定，否則價格包括運輸、包裝、保險及技術諮詢。製造費用於合同中訂明，一般參考市場價格以及勞工、生產進度、技術複雜程度及訂單量等因素釐定。付款通常以銀行轉賬或其他約定方式進行，除非另有約定，我們一般在驗收貨物及收到發票後60天內支付100%的合同款項。
- **檢驗、補救措施及質保。**我們有權在收貨時檢驗產品，倘發現缺陷或不符之處，可要求外協廠商維修、更換或接受產品退貨。承包商須對外包工序或產品的缺陷或瑕疵負責，並必須承擔相關費用，我們可根據協議尋求賠償。承包商通常亦提供質保期（於合同中訂明），在此期間，其負責免費維修或更換瑕疵產品。
- **保密。**雙方均須對協議條款以及任何技術或商業資料保密。

## 業 務

- 終止。協議可於屆滿時、經雙方協商一致或任何一方發生重大違約時終止。

於2023年、2024年及2025年，我們分別委聘19名、25名及24家外協廠商，製造費用分別為人民幣9.2百萬元、人民幣24.5百萬元及人民幣35.3百萬元。就我們所知，所有該等外協廠商均為獨立第三方。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們與外協廠商並無任何重大糾紛，亦無就外包產品或流程發生任何重大產品缺陷或違約。

## 客戶、銷售及營銷

### 我們的客戶及客戶服務

憑藉我們具競爭力的產品組合及廣泛的銷售專業知識，我們已建立穩固的客戶基礎，涵蓋多家全球領先的PCB及半導體製造商。該等客戶被廣泛認可為半導體及PCB行業的引領者。我們服務及留住該等優質頂級客戶的能力，彰顯了我們強大的客戶粘性及其行業聲譽，為我們業務的持續拓展奠定了堅實的基礎。

我們為全球客戶提供全生命週期的設備維保服務，以確保我們的設備始終滿足彼等的生產要求。我們在全國範圍內戰略性地設立了區域銷售中心，包括我們位於深圳及蘇州的附屬公司，從而實現對華南、華東及華中地區的全面銷售覆蓋及技術支持。與此同時，我們通過銷售網絡拓展海外市場，加大東南亞（如泰國）產業佈局，同步輻射日韓等市場。我們多年的市場積累在下游客戶中建立了良好的口碑，為我們通過此區域性策略開拓新客戶提供了良好的市場基礎。

我們已進一步構建我們的銷售組織，以契合我們各業務分部的獨特性。就我們的PCB直接成像設備及自動線系統的銷售而言，我們已分別為華南、華東、華中及海外市場設立專門的銷售部門。此架構有助於我們滿足區域客戶需求並應對市場趨勢及反饋。此外，我們亦為半導體直寫光刻設備及自動線系統的銷售設立了專門的銷售部門，確保專注於市場開發，並為全球半導體行業客戶的獨特需求提供專業支持。我們根據客戶需求及行業動態審視及調整銷售策略。通過該差異化的銷售架構，我們能夠優化資源配置、加強與客戶的關係，並推動我們設備在全球的持續銷售增長。

此外，我們與客戶保持密切聯繫，以深入了解彼等的需求，並高度重視幫助客戶正確使用我們的產品。我們的研發團隊及銷售部門與客戶頻繁討論，以探討預期的客戶需求及相關的設備更新。我們直接從客戶處收集反饋，以獲取有助於推動我們業務及營運發展的見解。我們致力於為全球客戶群提供優質的端到端服務，此舉進一步鞏固了我們的行業影響力及聲譽。

## 業 務

### 主要客戶

於往績記錄期間，我們的客戶主要為PCB及半導體製造商，而小部分客戶為經銷商。下表載列於往績記錄期間各年度本集團五大客戶的基本資料：

#### 截至2023年12月31日止年度

| 客戶                       | 供應的產品              | 來自客戶的<br>營業收入<br>(人民幣<br>千元) | 佔營業總收入<br>百分比<br>(%) | 與本集團業務<br>關係的時長 | 信貸期    | 付款方式    |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|--------|---------|
| 客戶A <sup>(1)</sup> ..... | 印製電路板設備、半導體設備及維保服務 | 61,143                       | 7.4                  | 6年以上            | 6至12個月 | 電匯或票據托收 |
| 客戶B <sup>(2)</sup> ..... | 印製電路板設備、半導體設備及維保服務 | 44,024                       | 5.3                  | 6年以上            | 6至12個月 | 電匯或票據托收 |
| 客戶C <sup>(3)</sup> ..... | 印製電路板設備及維保服務       | 38,329                       | 4.6                  | 6年以上            | 3至6個月  | 電匯      |
| 客戶D <sup>(4)</sup> ..... | 印製電路板設備、半導體設備及維保服務 | 28,796                       | 3.5                  | 3年以上            | 3至6個月  | 電匯      |
| 客戶E <sup>(5)</sup> ..... | 印製電路板設備、半導體設備及維保服務 | 22,462                       | 2.7                  | 7年以上            | 6至15個月 | 電匯或票據托收 |
| 總計 .....                 |                    | <b>194,754</b>               | <b>23.5</b>          |                 |        |         |

#### 截至2024年12月31日止年度

| 客戶                       | 供應的產品                             | 來自客戶的<br>營業收入<br>(人民幣<br>千元) | 佔營業總收入<br>百分比<br>(%) | 與本集團業務<br>關係的時長 | 信貸期     | 付款方式    |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|---------|---------|
| 客戶E .....                | 印製電路板設備、半導體設備及維保服務 <sup>(1)</sup> | 74,354                       | 7.8                  | 7年以上            | 6至15個月  | 電匯或票據托收 |
| 客戶F <sup>(6)</sup> ..... | 印製電路板設備、半導體設備及維保服務                | 67,041                       | 7.0                  | 6年以上            | 12至24個月 | 電匯      |
| 客戶C .....                | 印製電路板設備及維保服務                      | 65,366                       | 6.9                  | 6年以上            | 3至6個月   | 電匯      |
| 客戶D .....                | 印製電路板設備、半導體設備及維保服務                | 47,124                       | 4.9                  | 3年以上            | 3至6個月   | 電匯      |
| 客戶G <sup>(7)</sup> ..... | 印製電路板設備及維保服務                      | 34,614                       | 3.6                  | 2年以上            | 3至6個月   | 電匯      |
| 總計 .....                 |                                   | <b>288,499</b>               | <b>30.2</b>          |                 |         |         |

## 業 務

### 截至2025年12月31日止年度

| 客戶                       | 供應的產品              | 來自客戶的<br>營業收入<br>(人民幣<br>千元) | 佔營業總收入<br>百分比<br>(%) | 與本集團業務<br>關係的時長 | 信貸期     | 付款方式    |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|---------|---------|
| 客戶D .....                | 印製電路板設備、半導體設備及維保服務 | 192,624                      | 13.7                 | 3年以上            | 3至6個月   | 電匯      |
| 客戶E .....                | 印製電路板設備、半導體設備及維保服務 | 188,632                      | 13.4                 | 7年以上            | 6至15個月  | 電匯或票據托收 |
| 客戶F .....                | 印製電路板設備、半導體設備及維保服務 | 99,562                       | 7.1                  | 6年以上            | 12至24個月 | 電匯      |
| 客戶H <sup>(8)</sup> ..... | 印製電路板設備及維保服務       | 56,508                       | 4.0                  | 3年以上            | 3至6個月   | 電匯      |
| 客戶I <sup>(9)</sup> ..... | 印製電路板設備及維保服務       | 48,252                       | 3.4                  | 7年以上            | 3至6個月   | 電匯      |
| <b>總計 .....</b>          |                    | <b>585,578</b>               | <b>41.6</b>          |                 |         |         |

附註：

- (1) 一家專門從事高精度印製電路板研發及製造的國家級高新技術企業。
- (2) 一家於深圳證券交易所上市的公眾公司。為一家專門從事印製電路板設計、研發、生產及銷售的高新技術企業。
- (3) 一家於深圳證券交易所上市的公眾公司。為一家專門從事印製電路板研發、生產及銷售的中外合營高新技術企業。
- (4) 一家於深圳證券交易所上市的公眾公司。產品廣泛應用於通信電子、消費電子、汽車電子及AI服務器等領域。
- (5) 一家於深圳證券交易所上市的公眾公司。產品廣泛應用於AI服務器、新能源汽車及5G通信等領域。
- (6) 一家於上海證券交易所上市的公眾公司。專注於印製電路板及高端電子材料的研發、生產及銷售。
- (7) 全球領先的高端多層印製電路板製造商，其產品廣泛應用於汽車電子、消費電子等領域。
- (8) 一家於東京證券交易所上市的公眾公司。其核心業務包括曝光系統、檢測設備及蒸鍍設備等高端設備的研發、製造及銷售。
- (9) 一家於深圳證券交易所上市的公眾公司，專注於三大業務：印製電路板(PCB)、封裝基板及電子組裝。

就董事所知，於最後實際可行日期，概無董事及其各自的聯繫人或任何持有我們已發行股本5%以上的股東於往績記錄期間各年度的任何五大客戶中擁有任何權益。

## 業 務

### 我們的銷售網絡

於往績記錄期間，我們建立了廣泛的銷售網絡，使我們能夠將PCB直接成像設備及半導體直寫光刻設備帶給廣大客戶，從而提升我們的品牌聲譽並鞏固我們在全球市場上的競爭優勢。我們主要與直銷客戶訂立買賣協議，我們相信此舉對預測及滿足客戶需求至關重要。為進一步擴大市場份額，我們亦通過經銷商銷售產品，經銷商再將我們的產品銷售予其他公司。於往績記錄期間，我們的經銷商合作夥伴關係在加速海外市場滲透方面發揮了重要作用，戰略重點是深化我們在東南亞的國際佈局，同時將我們的商業版圖擴展至日本及韓國。

下表載列營業收入於所示年度按客戶貢獻劃分的明細(以絕對金額及佔我們營業總收入的百分比呈列)：

|            | 截至12月31日止年度    |              |                |              |                  |              |
|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
|            | 2023年          |              | 2024年          |              | 2025年            |              |
|            | 金額             | %            | 金額             | %            | 金額               | %            |
|            | (人民幣千元，百分比除外)  |              |                |              |                  |              |
| 直銷客戶 ..... | 804,421        | 97.1         | 932,732        | 97.8         | 1,349,967        | 95.9         |
| 經銷.....    | 24,434         | 2.9          | 21,211         | 2.2          | 58,155           | 4.1          |
| 總計.....    | <b>828,855</b> | <b>100.0</b> | <b>953,943</b> | <b>100.0</b> | <b>1,408,121</b> | <b>100.0</b> |

下表載列營業收入於所示年度按最終付運目的地劃分的各地區明細(以絕對金額及佔我們營業總收入的百分比呈列)：

|            | 截至12月31日止年度    |              |                |              |                  |              |
|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
|            | 2023年          |              | 2024年          |              | 2025年            |              |
|            | 金額             | %            | 金額             | %            | 金額               | %            |
|            | (人民幣千元，百分比除外)  |              |                |              |                  |              |
| 中國內地 ..... | 768,619        | 92.7         | 765,810        | 80.3         | 1,133,533        | 80.5         |
| 境外市場       |                |              |                |              |                  |              |
| 泰國.....    | —              | —            | 115,992        | 12.2         | 140,343          | 10.0         |
| 日本.....    | 17,575         | 2.1          | 21,211         | 2.2          | 56,508           | 4.0          |
| 中國台灣.....  | 34,259         | 4.2          | 42,374         | 4.4          | 49,449           | 3.5          |
| 其他地區.....  | 8,402          | 1.0          | 8,556          | 0.9          | 28,288           | 2.0          |
| 總計.....    | <b>828,855</b> | <b>100.0</b> | <b>953,943</b> | <b>100.0</b> | <b>1,408,121</b> | <b>100.0</b> |

### 直銷客戶

於往績記錄期間，我們的直銷客戶主要包括PCB及半導體製造商。於2023年、2024年及2025年，我們自直銷客戶產生的營業收入分別為人民幣804.4百萬元、人民幣932.7百萬元及人民幣1,350百萬元，分別佔各年度營業收入的97.1%、97.8%及95.9%。

## 業 務

我們與直銷客戶訂立的買賣協議的主要條款載列如下：

- **產品規格。**我們在協議中訂明產品名稱、規格、型號及數量。
- **質量控制。**產品質量須符合合同所載客戶指定的特定標準。
- **價格。**倘主銷售協議為框架協議，產品價格一般在每份採購訂單中訂明。
- **付款條款。**我們的直銷客戶通常須於簽訂合約後指定期限內預付總合同價值的30%、於驗收產品後再支付60%，並於保修期屆滿後結清餘下的10%。
- **保密。**未經事先同意，任何一方向另一方提供的所有保密資料均不得向任何第三方披露。
- **交付及運輸。**我們通常在收到首付款後將產品交付至客戶的指定地點。運輸費用一般由我們承擔。
- **質保。**我們通常為直銷客戶提供一至兩年的產品質保。

於往績記錄期間，我們策略性地委聘第三方銷售代理，以利用彼等於本地市場的專業知識及市場影響力。該等代理通常為其各自行業內信譽良好的貿易公司，在提高我們產品的可及性方面發揮了重要作用。通過利用彼等的本地優勢，我們成功擴大了銷售網絡，海外客戶亦有所增長。我們向該等第三方銷售代理支付服務費，以助我們擴大銷售網絡。於2023年、2024年及2025年，我們錄得的第三方銷售代理服務費分別為人民幣9.4百萬元、人民幣18.4百萬元及人民幣23.9百萬元。我們與由第三方銷售代理介紹的終端客戶直接訂立銷售合同。於2023年、2024年及2025年，我們分別委聘三名、兩名及九名第三方銷售代理，透過彼等產生的銷售收益分別為人民幣65.2百萬元、人民幣48.8百萬元及人民幣134.6百萬元。該等第三方銷售代理主要位於中國深圳、蘇州、徐州、惠州、上海、中國台灣及泰國。

我們與第三方銷售代理訂立的協議的主要條款載列如下：

- **期限。**我們與第三方銷售代理的協議期限通常為兩年。
- **佣金。**應付予第三方銷售代理的佣金率視乎終端客戶所在地區而定。一般而言，我們為第三方銷售代理設定不同的佣金率，範圍約為相關銷售交易最終合同金額的5%至11%。根據灼識諮詢的資料，該佣金安排符合行業慣例。

## 業 務

- **銷售代理的責任。**銷售代理通常負責在相關地區營銷及推廣我們的產品及品牌。
- **我們的責任。**倘我們的產品有任何變動，我們有義務及時向第三方銷售代理提供最新的產品目錄。
- **知識產權。**為推廣協議項下的產品，我們已授予銷售代理非獨家權利使用我們的「CFMEE」商標及與我們相關的其他商標，惟須事先取得我們的書面同意。
- **定價。**我們在代理區域內的產品銷售價格由我們與相關第三方銷售代理經雙方協商釐定。
- **終止。**協議於屆滿時終止，或可經雙方協商一致終止。倘另一方存在欺詐、破產或嚴重違反協議的情況，任何一方可發出書面通知終止協議。

## 經銷

於往績記錄期間，我們亦與擁有本地客戶資源的經銷商合作，以在東南亞、日本及韓國等若干地區實現有效的客戶拓展及市場滲透。我們的經銷商通常為PCB及半導體生產設備行業的貿易公司。於往績記錄期間，我們的經銷商位於香港、韓國及日本。我們與經銷商保持買賣關係。於2023年至2025年，我們的經銷商數目穩定維持於三家，並無變動，而我們於2025年上半年新增一家經銷商，透過彼等，我們將產品銷往主要位於越南、日本、泰國及韓國的客戶。於2023年、2024年及2025年，我們自經銷商銷售產生的營業收入分別為人民幣24.4百萬元、人民幣21.2百萬元及人民幣58.2百萬元，佔各年度營業收入的2.9%、2.2%及4.1%。

## 經銷商管理

我們對不同類型的產品採取差異化的定價策略。我們重視對經銷商的管理，並與彼等保持良好的合作關係。我們的經銷商管理涵蓋訂單及結算管理、營銷支持及培訓以及評估。我們要求定期對經銷商進行全面評估，評估一系列標準，包括銷售業績、庫存、項目獲取、技術支持、主要客戶協助、付款、營運效率及合規狀況等。

為將內部競爭風險降至最低，我們通常就經銷商採取以下措施：(i)在選擇經銷商時，我們會考慮彼等各自的地理覆蓋範圍，以避免一個地區內經銷商之間的潛在競爭；(ii)我們的經銷協議訂明指定的經銷地區；及(iii)我們定期與經銷商溝通，以監控彼等銷售活動的各個方面，並跟蹤經銷商之間任何潛在的內部競爭。

---

## 業 務

---

我們主要因常規更替及市場覆蓋範圍擴大而與新經銷商建立業務關係。我們終止與經銷商的業務關係，主要由於彼等業務發生變更及過去數個期間PCB及半導體生產設備行業的市場波動。

就我們所知，我們所有的經銷商均為獨立第三方。除與我們的日常經銷安排外，該等經銷商與本公司、我們的附屬公司、我們的股東、董事或高級管理層或彼等各自的任何聯繫人之間並無其他關係。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們與該等已終止合作的經銷商並無重大未解決的糾紛或訴訟。對於已與我們終止業務關係的經銷商，倘若彼等仍有剩餘庫存，除質量問題外，我們將按協議規定不接受彼等的產品退貨。

### 我們與經銷商的安排

我們與經銷商的關係乃屬標準的買賣關係。我們通常與經銷商訂立買賣協議。我們一般不允許經銷商委聘次級經銷商。我們與經銷商訂立的標準銷售協議的主要條款載列如下：

- **期限。**經銷協議的期限通常為一至兩年。
- **付款條款。**我們的經銷商通常須於發貨前預付總合同價值的預定百分比，並於收到我們的產品後在協定時限內結清餘額。
- **定價。**我們產品的銷售價格由我們與經銷商經雙方協商釐定。
- **銷售目標。**我們一般根據相關市場的年度預測為經銷商設定銷售目標。
- **產品規格。**我們的經銷商通常會列明所訂購產品的產品規格，如產品名稱、型號、配置及功能。
- **產品退换货。**經銷商一般不得退回或更換產品，惟產品質量問題除外。我們須承擔因瑕疵產品產生的任何費用。
- **質保。**我們一般為交付予經銷商的产品提供一年質保期。
- **保密。**未經事先同意，任何一方向另一方提供的所有保密資料均不得向任何第三方披露。
- **終止。**協議於屆滿時終止，或倘另一方違約且未能在規定期限內糾正違約行為，守約方可終止協議。

---

## 業 務

---

### 營 銷

我們採取以客戶為中心的營銷方式來建立及擴展與客戶的關係。我們直接從客戶處收集反饋，以獲取有助於推動我們業務及營運發展的見解。我們利用線下及線上營銷渠道(如我們的網站、行業展覽、研討會及行業媒體)來展示我們最新的產品及技術成果。該等針對性營銷策略滿足了我們的業務推廣需求，提升了我們的品牌知名度，並吸引了潛在客戶的注意。隨著我們在國內及全球的不斷擴張，我們持續優化銷售及營銷網絡，以確保我們在現有及新市場均有足夠的地理覆蓋。我們在全國範圍內戰略性地設立了區域中心，包括深圳分公司和蘇州子公司，從而實現對華南、華東及華中地區的全面銷售覆蓋。與此同時，我們通過銷售網絡拓展海外市場，加大東南亞產業佈局，同步輻射日韓等市場。具體而言，我們已在泰國成立一家附屬公司以進一步增強我們的當地業務及服務能力，且截至2025年12月31日已向泰國客戶交付約227台設備。

我們通過與各行業領先客戶建立廣泛而深入的合作夥伴關係，已樹立了強大的品牌聲譽及顯著的行業影響力。我們針對不同行業的客戶採取量身定製的策略，並在新興應用領域的業務發展上投入大量資源。我們充分利用參加展會的機會，向國內外客戶展示我們最新的產品及技術，提升品牌知名度，並與潛在客戶建立業務關係。

### 定 價

我們針對不同類型的產品採取差異化定價策略。我們在釐定產品價格時會考慮多種因素，包括採購及生產成本、產品性能、技術差異化、客戶需求、供應鏈動態及各產品的預期毛利率，以及其他商業條款。我們亦會評估競爭格局，包括整體市場狀況以及同業提供的可比較產品的市場價格。

### 售 後 服 務

我們相信，能否獲得高質量的售後服務乃屬消費者購買決策背後的重要考慮因素。我們秉持「以客戶為中心」的價值觀及「滿足客戶需求、超越客戶期待」的服務理念。我們已在主要市場建立本地化服務團隊，使我們能夠快速響應客戶需求，並提供現場技術支援、維護及培訓。我們的全球銷售網絡乃屬客戶接收及時的全天候售後服務的主要聯絡點，服務範圍涵蓋交付、次品的退換貨，以及為確保我們產品的正確安裝及應用條件的驗證而設的培訓。我們相信，提供令人滿意的售後服務乃屬我們成功的關鍵決定因素。此舉提升了我們產品的價值鏈，並提高了客戶及終端用戶的滿意度。

## 業 務

我們提供量身定製的產品退換貨服務，以滿足客戶的要求及疑慮。我們已經建立了標準的產品退貨程序。當客戶對我們的產品提出質量問題時，我們的技術團隊及時核實問題。經內部分分析及審查確認產品存在缺陷後，我們的質量控制部門通知銷售團隊發起退貨請求，並完成退換貨程序。於2023年、2024年及2025年，我們錄得的產品退回金額分別為人民幣零元、人民幣4.5百萬元及人民幣8.3百萬元，分別佔我們同年收益的零、0.5%及0.6%。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無經歷任何對我們的聲譽、業務營運或財務狀況產生不利影響的重大產品退回、產品召回，亦無遭受任何重大產品責任索賠。我們相信該等安排有助於與客戶建立可信、穩定的關係，並維持我們的長遠增長。我們的銷售團隊須參加定期培訓課程，以提升彼等的知識及技能。為確保售後服務的質量，我們定期對代表的表現進行評估。

此外，我們的銷售團隊定期進行客戶滿意度評估，收集及分析客戶對我們產品及服務的滿意度信息。通過此舉，我們能夠深入了解我們的優勢所在，並識別改進的機會。該等評估亦作為一個平台，讓我們跟進客戶不斷變化的需求。通過了解客戶未來的要求及偏好，我們可以探索進一步的合作機會，並為產品迭代及創新產生新想法。

### 質量控制

我們已制定全面的政策及詳細的程序以確保產品質量，並依託於我們的數智化舉措及可持續發展整合戰略。我們已部署多個質量管理系統及先進的數字平台，涵蓋研發、生產及供應鏈營運。通過我們的CRM系統、ERP系統及飛書平台等多個管理系統，我們實施從市場接觸到售後服務的端到端數字化控制，實現實時數據採集、分析及共享可見性，以標準化工作流程並改善跨職能協調。我們亦已獲得包括ISO-9001:2015在內的各項認證。

我們已設立專門的質量控制部門，通過系統性的預防、監督、檢驗及持續改進，確保從原材料檢驗到產品交付的每個階段均持續符合質量標準及客戶要求，從而提升產品質量、維護我們的品牌聲譽及降低質量風險。我們的質量控制部門由兩個專業職能團隊組成，即質量保證（「QA」）團隊及質量控制（「QC」）團隊。我們的質量保證團隊負責建立、維護及持續改進我們的質量控制體系，並在整個生產過程中預防及管理質量風險。我們的質量控制團隊主要負責產品符合性的檢驗、測試及評估，進行客觀及時的檢驗以識別及攔截不合格產品，並提供準確的質量數據以支持管理決策。我們的質量保證及質量控制團隊分工明確、緊密協作，共同構成我們生產的全面品質保證框架。

## 業 務

截至2025年12月31日，我們擁有一支由24名僱員組成的質量控制團隊。我們已加強標準化生產及質量管理培訓，讓全體員工參與質量保證舉措，以將質量控制問題的風險降至最低。我們亦在整個組織內倡導質量意識文化，並設有定期的內部審核及反饋機制，以推動持續改進。我們已開發一個涵蓋產品研發、供應鏈、生產流程及客戶服務的全生命週期質量控制體系，確保所有產品的製造及組裝均符合一致的標準及質量。

我們的質量控制措施包括以下各項：

- **產品研發質量控制**：我們採用一體化產品開發（「IPD」）模式，充分利用由各細分市場技術需求驅動的研究成果，並實施先進的產品質量控制計劃，以在研發階段有效預防設計缺陷及潛在的質量問題。我們已設立專門崗位，負責監督研發流程的完整性，並在每個項目階段對關鍵交付成果進行質量評審，確保在整個產品開發過程中進行嚴格的流程管理。我們亦進行定期的設計驗證及可靠性測試，以確保新產品在量產前符合內部及客戶標準。
- **供應鏈質量控制**：我們實施嚴格的供應商資格認證規程，特別是針對核心系統及專用組件，並選擇少數經認證的供應商以建立長期穩定的合作夥伴關係。我們已建立涵蓋整個供應商生命週期的閉環管理機制，包括引進、績效評估及退出。通過定期的商業談判，我們獲取最優的採購條款，同時要求嚴格遵守我們的技術規格。我們通過質量認證、來料檢驗、過程監控及協同改進，確保供應商持續符合我們的質量要求。此外，我們從質量、成本及交付等多個維度對供應商進行持續的績效評估，以確保穩定可靠的供應。我們亦為主要供應商提供培訓及技術支持，以提升其質量管理能力，並確保其與我們的標準保持一致。
- **生產過程質量控制**：我們嚴格遵守生產工藝標準，並確保SOP覆蓋整個生產過程，指導僱員進行標準化操作。我們已設立工序質量控制點，並實施由自檢、互檢及專檢組成的三級檢驗機制，以及時發現及處理質量問題。此外，我們在過程中、產成品及出貨前等關鍵階段設立了質量檢驗站，以全面監控產品質量，並確保最終交付的產品質量符合客戶要求。我們亦利用數字化監控工具及自動化檢測設備，以進一步加強過程控制及可追溯性。
- **客戶服務**：我們已建立一個覆蓋東南亞、日本及韓國目標市場的全球營銷及服務網絡，在產品的整個生命週期內提供本地化的技術支持及售後服務。我們亦已建立標準化的客戶投訴處理程序，以確保及時回應客戶的疑慮，並積極收集客戶反

---

## 業 務

---

饋以持續改進服務。此外，我們已實施高效的產品質量事件追溯機制，使我們能夠準確識別問題環節及根本原因，推動內部產品改進及管理風險召回，從而確保產品質量控制及提升用戶體驗。此外，我們定期分析客戶反饋及服務數據以識別趨勢，並主動解決潛在的質量問題，進一步鞏固我們對客戶滿意度的承諾。

### 供應鏈管理

#### 原材料及採購

我們採購的主要原材料包括運動平台及組件、圖形發生器、光路組件、曝光光源及自動化控制系統等。

就原材料採購而言，我們推進供應鏈數字化轉型，建立全球供應商協同平台，從而縮短業務處理時間並改善各種組件的交付週期。我們利用SRM系統來優化倉庫運營、推動按需配送及提高周轉效率。我們已開發一站式採購協同管理平台及採購需求管理中心，從而為我們的高效率、高質量及可持續製造奠定堅實基礎。

原材料的價格主要根據我們與供應商之間的競爭性談判定價。價格通常在框架協議中訂明的指定期限內固定。倘市場出現重大價格波動，經雙方同意後，價格可參考當時的市場價格進行調整。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無遇到對我們營運產生重大影響的原材料質量或交付問題。

### 我們的供應商

#### 供應商選擇與管理

我們根據對原材料的需求及市場供應情況制定供應商選擇策略。在選擇供應商時，我們會考慮多種因素，包括但不限於供應商的背景、技術能力、產品質量、成本、生產能力及交付效率。我們已實施全面的供應商管理體系，定義供應商的加入、合格供應商的日常管理以及不合格供應商的淘汰，以提高我們的供應商管理水平。

在選擇過程中，我們主要關注供應商的資質、遵紀守法情況與合規性、行業經驗、質量保證體系及研發能力，同時亦考慮社會責任及其他維度，包括環境、有害物質安全、貿易安全等方面。我們亦會審查彼等的生產流程、產品質量及市場聲譽。我們對原材料實施嚴格的可追溯流程，追溯至其源頭，以確定其符合我們標準所訂立的更高基準。我們可能會對潛在供應商的生產基地進行現場考察。潛在供應商亦須提供樣品供我們測試及評估。供應商隨後會被列入我們的合格供應商名單。我們通常優先考慮該等合格供應商，並在原材料質量及功能滿意的情況下進行價格比較。

---

## 業 務

---

我們的主要原材料來源地為中國。我們每季度進行績效評估，以確保供應商的質量及服務標準，並將評估結果及整改要求告知供應商。此外，我們進行批量檢查及持續的可靠性測試，以確保我們產品的一致性及其質量。倘若若干原材料及組件未能達到我們嚴格的測試標準，我們將要求退回受影響的批次。供應商有義務對退回的產品進行分析，找出不合規的原因，並提出可行的解決方案。

### 與供應商的協議

我們通常與供應商訂立框架供應協議，其主要條款載列如下：

- **產品規格。**我們在向供應商發出的每份採購訂單中訂明產品名稱、製造商或品牌、規格、價格、數量、交付時間及其他詳細項目。倘有需要，我們亦可能在採購訂單中載入技術要求或質量標準。
- **定價。**向我們作出的報價乃根據市況釐定，並載於採購訂單。
- **付款及信貸期。**我們通常獲授予30至60天的信貸期。
- **物流。**供應商通常負責將產品交付至我們在每份採購訂單中指定的地址。供應商通常負責與採購材料相關的物流及運輸成本。
- **質量保證。**產品通常根據與我們供應商協定的規格獲驗收。倘於質保期內出現任何質量問題，我們有權要求更換或退回產品。
- **保密。**我們通常要求供應商對我們的商業秘密及專有技術保密。
- **終止。**協議可於屆滿時、經雙方協商一致或任何一方發生重大違約時終止。

### 反回扣措施

一套有效的反回扣政策及程序對於確保我們質量保證及供應鏈網絡的完整性，以及管理我們的成本至關重要。我們的反回扣措施及舉措包括以下各項：

- **零容忍。**所有供應協議均載有禁止賄賂及回扣的條款，任何違反該等條款的行為均可能導致對相關供應商的嚴厲處罰，並可能導致其作為我們供應商的資格被終止。我們將立即解僱任何被發現涉及任何賄賂或回扣事件的僱員。

## 業 務

- **舉報機制。**我們已與供應商訂立廉潔協議及產品承諾，並實施了舉報機制，我們的供應商及僱員可據此直接向我們的管理層及熱線舉報賄賂或回扣事件。
- **先進的管理制度及政策。**我們已制定反商業賄賂制度，並實施了一系列內部監控措施及政策，以防止任何潛在的賄賂或回扣。

### 主要供應商

於往績記錄期間，我們的主要供應商主要包括運動平台及組件、圖形發生器、光路組件、曝光光源及自動化控制系統的製造商。下表載列於往績記錄期間各年度本集團五大供應商的基本資料：

#### 截至2023年12月31日止年度

| 供應商                       | 採購的產品      | 採購金額<br>(人民幣<br>千元) | 估採購總額<br>百分比<br>(%) | 與本集團業務關<br>係的時長 | 信貸期 | 付款方式    |
|---------------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----|---------|
| 供應商A <sup>(1)</sup> ..... | 數字微鏡器件     | 95,981              | 20.4                | 6年以上            | 兩個月 | 電匯/信用證  |
| 供應商B <sup>(2)</sup> ..... | 高精度工作台     | 45,941              | 9.8                 | 9年以上            | 一個月 | 電匯/銀行匯票 |
| 供應商C <sup>(3)</sup> ..... | 激光模塊       | 26,435              | 5.6                 | 3年以上            | 兩個月 | 電匯/銀行匯票 |
| 供應商D <sup>(4)</sup> ..... | 激光模塊       | 16,471              | 3.5                 | 6年以上            | 兩個月 | 電匯/銀行匯票 |
| 供應商E <sup>(5)</sup> ..... | 個人電腦及圖形工作站 | 15,635              | 3.3                 | 7年以上            | 兩個月 | 電匯      |
| <b>總計</b> .....           |            | <b>200,463</b>      | <b>42.6</b>         |                 |     |         |

#### 截至2024年12月31日止年度

| 供應商                       | 採購的產品  | 採購金額<br>(人民幣<br>千元) | 估採購總額<br>百分比<br>(%) | 與本集團業務關<br>係的時長 | 信貸期 | 付款方式    |
|---------------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-----|---------|
| 供應商A.....                 | 數字微鏡器件 | 106,102             | 12.7                | 6年以上            | 兩個月 | 電匯/信用證  |
| 供應商B.....                 | 高精度工作台 | 76,637              | 9.2                 | 9年以上            | 一個月 | 電匯/銀行匯票 |
| 供應商F <sup>(6)</sup> ..... | 激光模塊   | 55,182              | 6.6                 | 4年以上            | 兩個月 | 電匯/銀行匯票 |
| 供應商D.....                 | 激光模塊   | 46,516              | 5.6                 | 6年以上            | 兩個月 | 電匯/銀行匯票 |
| 供應商G <sup>(7)</sup> ..... | 激光耦合組件 | 39,931              | 4.8                 | 4年以上            | 兩個月 | 電匯/銀行匯票 |
| <b>總計</b> .....           |        | <b>324,368</b>      | <b>38.9</b>         |                 |     |         |

## 業 務

截至2025年12月31日止年度

| 供應商             | 採購的產品      | 採購金額<br>(人民幣<br>千元) | 佔採購總額<br>百分比<br>(%) | 與本集團業務關<br>係的時長 | 信貸期 | 付款方式    |
|-----------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----|---------|
| 供應商A .....      | 數字微鏡器件     | 211,751             | 21.2                | 6年以上            | 2個月 | 電匯／信用證  |
| 供應商B .....      | 高精度工作台     | 98,080              | 9.8                 | 9年以上            | 1個月 | 電匯／銀行匯票 |
| 供應商D .....      | 激光模塊       | 52,413              | 5.2                 | 6年以上            | 2個月 | 電匯／銀行匯票 |
| 供應商G .....      | 激光耦合組件     | 30,527              | 3.1                 | 4年以上            | 2個月 | 電匯／銀行匯票 |
| 供應商E .....      | 個人電腦及圖形工作站 | 29,107              | 2.9                 | 7年以上            | 2個月 | 電匯      |
| <b>總計 .....</b> |            | <b>421,879</b>      | <b>42.2</b>         |                 |     |         |

附註：

- (1) 一家總部位於中國香港的全球性的技術產品、服務及解決方案供應商。全球領先的電子組件授權經銷商之一。
- (2) 一家總部位於中國廣東省深圳，專注於納米及微米級直線電機運動平台、半導體陶瓷組件、大理石組件等的公司。
- (3) 一家總部位於中國天津，專門從事大功率半導體激光組件及系統、手持激光焊接機研發、生產及銷售的高新技術企業，公司生產的高端半導體激光器廣泛應用於激光直接成像(LDI)、激光雷達、激光醫療美容及藍光激光加工等多個領域。
- (4) 一家總部位於中國廣東省東莞，專門從事半導體激光器研發、生產及銷售的公司。主營業務包括製造激光二極管、激光模塊、光纖耦合激光器等产品，廣泛應用於3D掃描、曝光顯影、機器視覺、醫療美容、雕刻切割等領域。
- (5) 一家總部位於中國福建省廈門，專注於為核心用戶及全球用戶提供基礎設施及商用終端解決方案的公司。
- (6) 一家總部位於中國江蘇省蘇州，從事激光成像技術、激光消散斑技術、半導體激光光源耦合技術及DLP/LCoS/CMOS引擎開發研究的公司。
- (7) 一家總部位於中國山東省濟南，專門從事半導體激光外延晶圓、激光巴條芯片、激光器件及激光模塊研發、生產及銷售的高新技術企業。

就董事所知，於最後實際可行日期，概無董事及其各自的聯繫人或任何持有我們已發行股本5%以上的股東於往績記錄期間各年度的任何五大供應商中擁有任何權益。

董事確認，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，本集團並無經歷任何與供應商供應有關的重大中斷、糾紛或延遲。

## 業 務

### 供應商與客戶重疊

於往績記錄期間各年度，在我們的五大供應商中，供應商B亦為我們的客戶，於往績記錄期間各年度向我們租賃物業。與供應商B的租賃安排主要為方便供應商B向我們供應產品而訂立，此乃由於供應商B為營運便利而需要在我們的物業內設立生產設施。我們的董事認為，該安排乃為合法商業目的及按正常商業條款訂立。於2023年、2024年及2025年，我們向供應商B的採購額分別為人民幣45.9百萬元、人民幣76.6百萬元及人民幣98.1百萬元，分別佔我們各年度總採購額的9.8%、9.2%及9.8%。於2023年、2024年及2025年，我們來自亦為我們客戶的供應商B的營業收入分別為人民幣1.0百萬元、人民幣1.1百萬元及人民幣1.1百萬元，佔我們各年度營業總收入的0.1%、0.1%及0.1%。於各年度，我們來自作為我們客戶的供應商B的毛利分別為人民幣0.8百萬元、人民幣0.9百萬元及人民幣0.9百萬元。

於往績記錄期間各年度，在我們的五大客戶中，客戶D亦為我們的供應商，於2023年、2024年及2025年向我們租賃物業。與客戶D的租賃安排主要是為了方便向客戶D提供售後服務，因為其為我們的主要客戶之一。我們向客戶D租賃銷售辦公室，以更好地滿足其需求。我們的董事認為，該安排乃為合法商業目的及按正常商業條款訂立。於往績記錄期間，我們主要向客戶D銷售PCB直接成像設備及半導體直寫光刻設備，包括MAS、NEX及RTR系列，並為該等產品提供全面的售後維護及支持服務。於2023年、2024年及2025年，我們來自客戶D的營業收入分別為人民幣28.8百萬元、人民幣47.1百萬元及人民幣192.6百萬元，分別佔我們各年度營業總收入的3.5%、4.9%及13.7%。於2023年、2024年及2025年，我們向亦為我們供應商的客戶D的採購額分別為人民幣0.1百萬元、人民幣0.4百萬元及人民幣0.4百萬元，分別約佔我們各年度總採購額的0.0%、0.1%及0.0%。於各年度，我們來自亦為我們供應商的客戶D的毛利分別為人民幣16.5百萬元、人民幣25.4百萬元及人民幣114.2百萬元。

根據灼識諮詢的資料，該等重疊在業內並不罕見，尤其是考慮到我們的領先市場地位、市場份額以及與多元化客戶及供應商基礎的廣泛關係。該等因素增加了若干方同時擔任我們客戶及供應商的可能性，與我們同時進行產品及服務的買賣。我們的董事認為，與重疊供應商客戶的交易乃按公平原則、在互不依賴的情況下按正常商業條款進行。我們向該等重疊供應商客戶進行銷售及自其進行採購的條款乃按個別基準磋商，且銷售及採購彼此之間互不關連，亦不互為條件。

### 競爭

根據灼識諮詢的資料，作為全球直寫光刻設備行業最重要的分部之一，全球PCB直接成像設備行業的競爭格局相對集中，前五大PCB直接成像設備供應商合計市場份額約為55.1%。根據灼識諮詢的資料，按2024年的營業收入計，我們是全球最大的PCB直接成像設備供應商，所獲市場份額為15.0%。

---

## 業 務

---

憑藉行業領先地位、深厚的行業經驗、強大的研發及製造能力、廣泛的產品組合以及龐大而穩定的客戶基數，我們相信我們已準備就緒，可在行業競爭中脫穎而出。我們認為，我們的競爭對手進入市場存在高壁壘，其中包括技術、規模化生產經驗、資本投資、供應鏈及客戶基礎等。請參閱「行業概覽」。

### 物流

我們致力於發展高效及透明的物流供應鏈，以確保客戶滿意度並提升我們的配送效率。我們委聘合格的第三方物流服務提供商，將成品從我們的生產設施運送至客戶指定的地點。我們為產品運輸設定了嚴格的標準，該等第三方物流服務提供商必須遵守，我們亦會評估第三方物流服務提供商的合規性及表現，以確保產品順利交付予客戶。通過持續改進，我們不斷提高交付的及時性、準確性及客戶滿意度，同時實現降低成本。就我們所知，所有該等物流服務提供商均為獨立第三方。

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無經歷任何對我們業務營運產生重大不利影響的重大延誤或不當處理貨物的情況。

### 存貨管理

我們的存貨主要包括原材料、在產品、成品及發出商品。

我們的供應鏈管理經過協調，以在下單、採購管理、產品製造、運輸及其他流程中實現協同效應及理想的資源分配。我們管理並維持足夠的存貨水平以支持生產。我們根據預測供應、市場分析以及對採購期內數量及採購價格波動的估計，分析並釐定採購策略。基於該等分析，我們為不同種類的存貨設定不同的合理及安全存貨水平，以應對客戶需求的變化及原材料價格的波動。

此外，我們通過我們的ERP系統實現存貨管理的數字化及標準化，從而提高了我們存貨管理流程的效率及準確性。我們亦會對產品進行重新測試，以確保其在達到指定儲存期後仍適用於其預期用途。

---

## 業 務

---

### 信息技術

信息技術系統對競爭力及高效營運至關重要。我們利用信息技術簡化業務流程並提升營運效率。我們已建立多個信息系統以支持各項業務職能。我們的主要信息技術系統載列如下：

- **ERP系統**。我們使用T100系統作為我們的核心ERP平台，並藉此建立了涵蓋供應鏈管理、生產及財務管理的端到端一體化解決方案。自實施以來，我們已實現跨部門的實時數據共享及流程可視化，從而提高效率並支持決策。
- **PLM系統**。我們已部署Teamcenter作為我們的產品生命週期管理（「PLM」）平台，使我們能夠以統一的方式管理及協作整個產品生命週期。其支持研發與製造協作以及技術文檔和設計數據的集中管理。
- **CRM系統**。我們使用CRM系統，對從市場線索生成、商機跟蹤到訂單履行及回款的整個銷售流程進行數字化及全面管理。其支持銷售協調及分析。
- **供應商關係管理系統**。我們已基於飛書平台開發了一套SRM系統，使我們能夠在供應鏈的各個環節實時共享數據並高效協作。其支持供應鏈協作、供應商質量及成本控制。

### 知識產權

我們依賴專有技術及生產訣竅來維持我們在經營所在市場的競爭地位，並通過廣泛的研發活動創造知識產權。我們的總體政策是，在中國及其他適當的司法管轄區，持續就具有商業意義的可專利開發項目申請專利。我們的專利組合涵蓋我們產品中使用的專有技術以及我們產品設計及生產流程的諸多方面。

我們主要通過知識產權法尋求保護我們的知識產權及專有權利，依賴於中國及其他國家的專利、商標、商業秘密及其他知識產權法的組合。截至最後實際可行日期，我們在中國已獲得237項註冊專利、54項註冊軟件版權、25項註冊商標及兩個域名，以及一項在日本的有效專利。

### 核心技術來源

我們的核心技術主要為自主研發，而外部引進主要限於若干組件、人才招聘及產學研合作。我們的自主研發技術涵蓋(i)先進的光刻紫外光源與曝光引擎技術、(ii)高精度、高速對準及自動對焦技術、(iii)高速、實時、高精度圖形處理技術，及(iv)高可靠性系統監測及自

## 業 務

動化標定技術等關鍵領域。我們的外部引進技術主要涉及採購核心組件(例如運動平台及光學模塊)，以及與頂尖大學及研究機構的合作項目。

### 為客戶帶來的技術優勢及商業效益

我們的技術優勢為我們的客戶轉化為切實的商業效益。例如，我們的激光直寫光刻技術解決了先進WLP或「2.5D」CoWoS工藝(特別是RDL工藝)中的一個關鍵痛點。在WLP工藝中，晶片貼裝階段的晶粒偏移是一個常見問題，主要由晶片鍵合設備的精度限制、基板翹曲及物料收縮所致。這導致RDL與IC焊盤之間的錯位，可能會導致短路、斷路並最終降低良率。傳統的基於掩膜版的光刻技術無法補償單個晶粒的偏移，因此焊盤上的所有IC均使用相同的掩膜版進行曝光，導致更高的返工率及報廢率。我們的激光直寫光刻技術(應用於WLP2000系列)能夠在RDL曝光前高解析度地測量每個晶粒在晶圓上的實際位置。測量出的晶粒偏移數據隨後被導入激光直寫系統，該系統為每個晶粒動態調整數字掩膜版，並進行實時曝光及誤差補償。這確保每個RDL焊盤均與相應的IC焊盤精確對準，從而顯著提高互連良率並減少缺陷的發生。因此，我們的客戶受益於產品質量提升、因返工及報廢減少而降低的生產成本，以及更大的工藝靈活性，因為無需為每個批次生產或更換實體掩膜版。該解決方案亦支持扇外型晶圓級封裝及2.5D/3D集成等先進封裝格式，幫助我們的客戶提升競爭力並在市場上贏得更多高端訂單。

我們已制定一系列內部監控政策及措施以保護我們的知識產權及商業秘密，其中包括：(i)實施我們的《知識產權管理制度》；(ii)對技術文件進行分類訪問管理；(iii)要求員工簽訂保密協議並進行定期培訓；(iv)限制外部人員進入研發區域；(v)對研發文件強制自動加密並禁止使用外部存儲設備；及(vi)作為我們知識產權管理體系的一部分對合約進行全面法律審查。我們積極為我們的技術創新尋求專利申請，並利用我們的專利權來維護我們的合法權益。同時，我們採取合理步驟來偵測可能侵犯我們知識產權的行為。我們依靠保密協議來保護我們在非專利專有技術和難以申請專利的製造過程中的權益。我們與僱員、供應商及其他戰略合作夥伴訂立的所有合同均由我們的內部法律團隊審閱及批准，以確保其包含足夠的保障措施以防止未經授權的披露。據我們所知及所信，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們的知識產權並未受到第三方的任何重大知識產權索賠。就我們所知及根據我們目前的業務運營，我們的核心技術概無於我們經營所在司法管轄區受到任何監管或限制(例如出口管制)，我們亦無收到任何相關主管部門的通知，指明我們的技術須遵守該等監管規定。

## 業 務

### 僱員

截至2025年12月31日，我們於中國擁有795名全職僱員，並於泰國擁有九名全職僱員。下表載列截至2025年12月31日按職能劃分的全職僱員人數：

| 業務職能           | 僱員人數       | 百分比<br>(%)   |
|----------------|------------|--------------|
| 研發.....        | 281        | 35.0         |
| 客戶服務.....      | 246        | 30.6         |
| 生產.....        | 120        | 14.9         |
| 銷售.....        | 32         | 4.0          |
| 質量控制.....      | 24         | 3.0          |
| 行政.....        | 10         | 1.2          |
| 財務.....        | 10         | 1.2          |
| 採購.....        | 8          | 1.0          |
| 人力資源.....      | 10         | 1.2          |
| 其他.....        | 63         | 7.8          |
| <b>總計.....</b> | <b>804</b> | <b>100.0</b> |

於往績記錄期間，我們主要通過招聘網站、校園招聘及內部推薦招聘僱員。我們與僱員訂立標準勞動合同，並與關鍵管理人員及專業人員訂立保密及不競爭協議。我們重視僱員的培訓及發展，以提高彼等的技術技能及整體表現。我們為新員工提供關於我們文化、業務及行業的入職培訓，以幫助彼等融入。我們亦為僱員提供由內部及外部專家主講的定製化持續培訓課程，以提高彼等在其執業領域的技術技能，並為關鍵崗位的幹部提供管理技能培訓計劃，包括領導力培訓。我們致力於為僱員提供公平及平等的機會，制定了涵蓋各級員工的職業發展及晉升路徑計劃，並定期進行績效評估。作為我們挽留人才策略的一部分，我們為僱員提供具競爭力的薪酬待遇，包括薪金及津貼、績效獎金以及長期激勵計劃，包括但不限於針對管理人員、高潛力人才及關鍵技術專業人員的員工持股計劃。我們已建立年度評審制度以評估僱員的表現，此乃屬我們釐定加薪及晉升決策的基礎。

我們一直致力於為僱員提供全面的社會福利、多元化的工作環境及廣泛的職業發展機會。我們致力於提供安全健康的工作場所，並通過嚴格的政策、有力的團隊成員教育、安全表彰獎勵以及對技術的持續投資來加強。我們通過提供一系列幫助員工保持最佳健康水平的計劃來支持團隊成員的身心健康。我們相信每個人都應得到尊重。我們致力於全國範圍內多元化團隊成員的教育、招聘、發展及晉升，並因我們對該等努力的承諾而獲得認可。

## 業 務

我們已為僱員建立工會。我們相信我們與僱員保持著良好的工作關係，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無經歷任何重大勞資糾紛或在為我們的營運招聘員工方面遇到任何困難。

### 社會保險及住房公積金

根據中國法律法規，我們須按我們員工的薪金、獎金及若干津貼的指定百分比，為員工的社會保險計劃及住房公積金作出供款，惟以地方政府不時規定的最高金額為上限。於往績記錄期間，由於（例如）部分僱員為方便在當地利用該等福利，傾向於在各自居住地繳納社會保險及住房公積金，因此我們委聘第三方代理機構為彼等繳納社會保險及住房公積金。我們已於2025年終止該等安排。截至2023年、2024年及2025年12月31日，該等僱員人數分別佔我們僱員總數約7.7%、7.4%及零。於2023年、2024年及2025年，我們透過該等第三方代理機構作出的供款分別為人民幣1.2百萬元、人民幣1.7百萬元及零。誠如我們的中國法律顧問所告知，根據中國法律法規，我們或會被責令使用自身賬戶（而非透過第三方賬戶付款）為僱員繳納社會保險費及住房公積金；且倘第三方人力資源機構未能按適用中國法律法規的規定為我們的僱員代繳社會保險費或住房公積金，我們或會被責令糾正有關失責行為，並為僱員足額繳納社會保險及住房公積金供款。

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們未為若干僱員全額繳納社會保險及住房公積金供款，乃主要由於彼等不願合作繳納該等款項，或彼等已選擇參加其居住地或戶籍所在地提供的當地農村社會保障制度。根據灼識諮詢的資料，居住在農村地區的僱員不願繳納社會保險及住房公積金供款的情況普遍。根據《中國社會保險法》及《住房公積金管理條例》，社會保險及住房公積金分為僱主部分及僱員部分。當全額繳款時，僱主及僱員均須作出供款，這將導致僱員的可支配收入減少。

根據《中國社會保險法》，倘用人單位未足額繳納社會保險費，有關部門可責令其於限期內繳納欠繳數額，並加收每日0.05%的滯納金；倘其於限期內仍未繳納逾期未繳的供款，可被處以欠繳數額一至三倍的罰款。根據《住房公積金管理條例》，倘用人單位未辦理住房公積金繳存登記及設立賬戶，主管部門可責令其限期改正；逾期不改正者，可被處以人民幣10,000元以上50,000元以下的罰款。倘用人單位逾期不繳、少繳住房公積金，主管部門可責令其限期繳存；逾期仍不繳存者，可向中國法院申請強制執行。

## 業 務

此外，根據最高人民法院於2025年7月31日頒布並於2025年9月1日實施的《最高人民法院關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(二)》，倘用人單位與勞動者約定或勞動者向用人單位承諾無需繳納社會保險費，人民法院應認定該等約定或承諾無效。儘管倘發生該等索償，可能會增加我們的合規成本，但基於並無重大員工投訴、我們持續採取的糾正措施，以及我們於往績記錄期間及截至最後實際可行日期概無受到任何行政處罰或被責令補繳供款，我們的董事認為，該解釋的實施預期不會對本集團的業務營運或財務狀況構成重大不利影響。

截至最後實際可行日期，我們尚未為上述不合規事宜所引致的潛在負債作出任何撥備。我們的中國法律顧問進一步告知，根據現行法律法規以及地方政府部門的要求，且基於無重大員工投訴的情況下，本集團因社會保險及住房公積金繳納事宜而受到重大行政處罰的風險較低，乃基於以下事實：於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，(i)我們並未因聘用第三方人力資源機構而受到任何行政處罰；(ii)我們並未收到中國有關部門發出的任何通知，要求我們補繳社會保險及住房公積金的差額；(iii)我們已審閱並取得相關社保主管部門出具的若干確認函，確認本集團任何成員公司概無因違反相關法律法規而被有關部門處以行政處分或處罰的記錄；及(iv)我們已取得單一最大股東組別出具的彌償保證函，就該等不合規行為所產生的任何索償、罰款及其他負債向本集團作出彌償。此外，根據於2018年9月21日頒佈的《人力資源和社會保障部辦公廳關於貫徹落實國務院常務會議精神切實做好穩定社保費徵收工作的緊急通知》，所有負責徵收社會保險的地方主管部門均嚴禁自行對企業歷史欠繳的社會保險費進行集中清繳。基於上述事實，我們的董事認為，與社會保險及住房公積金有關的風險預期不會對本集團的業務營運或財務表現構成重大不利影響。

我們已審閱我們的常規做法並已採納或計劃採納補救措施以糾正該等事件，包括：

- 與我們的僱員溝通，以尋求彼等的理解與合作，以遵守適用的繳費基數，而此亦要求我們的僱員作出額外供款；
- 建立內部監控機制，以監察我們對社會保險及住房公積金供款法規的持續合規情況，並監督任何必要措施的實施；及
- 諮詢我們的中國法律顧問，以獲取有關中國相關法律法規的意見，使我們及時了解相關監管發展。

---

## 業 務

---

此外，於2025年9月，經全面內部審查並與所有受影響僱員積極溝通後，我們已完全停止所有第三方機構代繳社會保險及住房公積金。展望未來，我們將繼續實施上述措施，以確保我們遵守相關法律法規項下的社會保險及住房公積金供款規定。我們計劃在切實可行的情況下盡快糾正該等不合規行為，並將承諾完全遵守相關法律法規，惟須待我們的每位僱員合作，在有關部門命令我們全額繳納社會保險及住房公積金供款的情況下作出全額供款。此外，我們將積極與相關地方主管部門溝通，以了解有關社會保險及住房公積金的適用法律法規的最新情況。我們亦將向僱員傳達該等更新信息，以使其更了解相關法律法規，從而加深彼等對監管規定的理解，以加強我們對適用法律法規的合規性。

### 保險

截至最後實際可行日期，我們持有與我們業務營運相關的各種保單。我們的資產、僱員安全及其他適用項目／風險由商業保險承保，例如僱主責任保險(包括意外保險及危疾保險(適用於實習生及出差僱員))、海外保險(適用於出國僱員)、財產保險及高級管理人員責任保險。我們認為我們的保險覆蓋範圍乃屬足夠，因為我們已按中國法律法規的要求及我們行業的商業慣例投保了所有強制性保單。然而，我們的保險覆蓋範圍未必足以涵蓋所有可能發生的損失。

然而，概不保證我們不會產生超出我們保單限額或相關承保範圍的損失或索賠。請參閱「風險因素 — 與我們的業務及行業相關的風險 — 我們的保單承保範圍可能無法充分涵蓋與我們的業務經營相關的所有索償」。

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無就我們的業務提出任何重大保險索賠。

### 貿易限制及國際制裁風險

#### 關稅

##### 概覽

若干外國司法管轄區可能因產品來源、業務所有權或其他原因而實施直接或間接影響中國公司的貿易限制(如關稅)。該等法律法規可能頻繁變動，其詮釋及執行涉及重大不確定性，並可能因國家安全顧慮或我們無法控制的政治或其他因素而加劇。

## 業 務

我們的產品(如進口至美國)將須繳納美國為針對自中國進口產品及中國半導體行業而徵收的各項關稅，詳情如下：

- (1) 我們的產品歸類於協調關稅表編號9010 50 20項下。因此，我們的產品須繳納根據1974年《貿易法》(經修訂)第301條(「**第301條**」)於2018年9月徵收的「清單3」項下的25%關稅(「**第301條關稅**」)。
- (2) 根據1974年《貿易法》第122條，我們的產品須繳納適用於所有美國進口產品的10%臨時關稅，自2026年2月24日起生效。在美國最高法院裁定根據《國際緊急經濟權力法》(「**《國際緊急經濟權力法》**」)徵收的關稅為不合法後，該措施於2026年2月20日頒布。該關稅最初設定為期150天，誠如美國總統所公告，預計將提高至15%，但他迄今尚未這樣做。

現任美國政府關稅政策的反覆無常及不確定性，使我們難以預測美國貿易關係的未來變化或新法律法規對我們業務的影響程度和衝擊。例如，於2024年12月23日，美國貿易代表辦公室根據1974年《貿易法》第301條展開調查，以審查據稱中國旨在主導半導體行業的行動。於2025年12月23日，該辦公室裁定，根據第301條，中國的行為、政策及常規屬可訴諸行動，儘管額外關稅將僅自2027年6月23日起徵收。另外，於2025年4月1日，美國商務部長根據1962年《貿易擴展法》第232條展開調查，以確定半導體、半導體製造設備及其衍生產品的進口對國家安全的影響。經調查後，美國總統於2026年1月14日公告，自2026年1月15日起，三類半導體(HTS編碼8471 50、8471 80及8473 30)須繳納25%的從價稅。

### 評估本集團的關稅風險

經我們的國際貿易法律顧問告知，我們的董事認為美國對來自中國或其他司法管轄區的進口商品徵收的現有及擬議關稅預計不會對本集團產生任何直接重大不利影響。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團並未向美國出口任何產品，亦無計劃或安排於[編纂]後向美國出口任何產品。此外，於往績記錄期間，本集團的產品主要擬在中國、中國台灣、日本、韓國、泰國、越南及馬來西亞作最終用途，且預計不會進口至美國。本集團或會間接承受美國關稅的影響，但我們的國際貿易法律顧問已告知，由於我們的客戶基數及銷售渠道於美國的風險有限，且我們的產品主要擬於美國境外最終使用，不大可能再出口至美國，故該等潛在間接影響並不重大。此外，任何未來政策變動均高度不確定，而其他司法管轄區現有關稅的影響已反映在本集團的財務表現及預測中。

經考慮我們的董事及國際貿易法律顧問的上述意見並進行相關盡職審查後，獨家保薦人並無注意到任何事宜，會合理地使其對我們的董事就本集團的美國關稅風險的上述意見在任何重大方面產生懷疑。

## 業 務

### 美國對外投資限制

#### 概覽

第14105號行政命令(由美國總統於2023年8月9日發佈)設立了對外投資安全計劃(「OISP」)，該機制旨在審查美國在「受關切國家」(包括中國(含香港及澳門))對若干國家安全技術的對外投資。OISP對投資於從事指定行業(包括半導體及微電子、量子信息技術及人工智能)「受涵蓋活動」的人士施加禁止或通知規定。我們可能被視為OISP下的「受涵蓋外國人士」，而鑑於我們從事開發及生產用於進行批量先進封裝的設備，美國人士對我們的投資很可能構成「禁止交易」。預期於[編纂]完成後，美國人士將可根據OISP項下的公開交易證券例外情況[編纂]於我們公開交易的H股，前提是該投資並無賦予超出標準少數股東保障的權利。儘管如此，OISP可能會增加美國投資者的合規負擔，這可能會對我們從該等投資者籌集資金的能力產生負面影響。

有關美國對外投資的規則仍有待進一步發展。於2025年12月18日，美國總統簽署《2026財年國防授權法》成為法律，其中包括《2025年全面對外投資國家安全法》(「COINS法案」)。儘管現有的OISP法規仍然有效，但COINS法案要求財政部在法案頒佈後450天內提出修訂建議。該等修訂將包括(其中包括)擴大受關切國家及受涵蓋技術的範圍(以納入高超音速系統)、修訂關鍵界定術語，以及建立正式的諮詢意見程序。

#### 評估OISP對本集團的影響

經我們的國際貿易法律顧問告知，我們的董事認為OISP的影響總體上是有限且可控的，原因如下：

- 除美國人士或其「受控外國實體」(定義見OISP)以外的人士所作的投資，一般不受OISP的約束，除非美國人士以構成「明知而指示」非美國人士進行「禁止交易」的方式參與。
- 我們可能被視為「受涵蓋外國人士」，且我們的業務構成「受涵蓋活動」，而美國人士對我們的[編纂]可能構成OISP下的「禁止交易」，因為我們從事用於批量先進封裝的設備的開發和生產。一項例外情況允許美國人士[編纂]於我們的公開交易證券，包括在非美國交易所交易的證券，只要該交易不賦予美國人士超出標準少數股東對受涵蓋外國人士的保護權利。儘管如此，OISP可能會增加美國投資者的合規負擔。尤其是，上述例外情況可能不適用於投資者在根據首次公開發售發行的股份正式開始公開交易前認購股份。

## 業 務

- OISP對本集團的業務營運並無影響，而對本集團的集資活動及投資者資格的影響則屬有限且可控。除美國人士或其「受控外國實體」(定義見OISP)以外的人士所作的投資，一般不受OISP的約束，除非美國人士以構成「明知而指示」非美國人士進行「禁止交易」的方式參與。此外，為本公司[編纂]提供附屬服務，包括盡職調查、包銷、與監管機構溝通及財務預測指引，而當中不涉及收購本公司股份者，既不屬於受涵蓋交易，亦不受OISP項下的禁令所規限。

經考慮我們的董事及國際貿易法律顧問的上述意見並進行相關盡職調查後，獨家保薦人並無注意到任何事宜，會合理地使其對我們的董事就OISP對本集團的影響的上述意見在任何重大方面產生懷疑。

### 國際制裁

若干國家或組織(包括相關司法管轄區)維持針對受國際制裁的若干國家、個人、實體以及國家／地區內行業或部門的經濟制裁和貿易限制。

#### 美國實施的國際制裁

##### (i) 與受美國制裁的中國客戶的交易

我們的國際貿易法律顧問已告知，本集團可能曾與兩名受制裁的中國客戶(「中國客戶」)進行有限的交易。該等中國客戶擁有一名共同的主要股東，而該股東於相關交易時已被列入OFAC管理的特別指定國民及被凍結人士(「特別指定國民」)名單。根據OFAC的「50%規則」，該等中國客戶本身於與本集團交易時，須受其股東所受的相同美國封鎖制裁所規限。

然而，我們的國際貿易法律顧問已告知，該等交易觸發美國二級制裁及OFAC執法行動的風險有限，原因如下：(1)交易的價值及數量相對微不足道；(2)本集團已決定終止與該等中國客戶的所有新訂及未決交易，直至及除非彼等的制裁獲解除；及(3)我們嚴肅對待制裁合規事宜，並正持續加強制裁政策及程序，包括正在實施各種補救措施以減輕制裁風險。

##### (ii) 與受美國制裁的中國供應商的交易

我們的國際貿易法律顧問進一步告知，本集團可能亦曾與一名受美國制裁的中國供應商(「中國供應商」)進行有限的交易。

中國供應商因據稱向俄羅斯及白俄羅斯的特別指定國民出口激光二極管，以用於裝甲戰車的光電瞄準器，而於2025年1月15日根據第14024號行政命令被指定為特別指定國民。該項指定並無附帶任何授權與中國供應商進行縮減交易的通用許可證。因此，自2025年1月15

## 業 務

日起，向中國供應商或由中國供應商擁有50%或以上權益的實體提供「重大」協助的非美國人士於該日後將面臨美國的次級制裁風險。

本集團於中國供應商成為特別指定國民後向其付款約人民幣48.8百萬元(6.97百萬美元)。根據於2024年訂立的合約向中國供應商作出的付款佔本集團該年度總銷售成本的3.05%，而根據於2025年訂立的合約作出的付款佔相應期間總銷售成本的2.82%。本集團亦於中國供應商被指定日期後從其收到價值約人民幣36.1百萬元(5.2百萬美元)的貨物。

我們已向我們的國際貿易法律顧問確認：

- 本集團已於2025年8月16日向中國供應商下達最後一份訂單，於2026年1月13日向中國供應商作出最後一筆付款，並已結清所有剩餘應付賬款。
- 本集團已決定自行生產替代零件，或向其他非受制裁目標供應商採購。
- 本集團與中國供應商或其聯屬公司並無任何其他不論直接或間接的待辦或未來交易。

根據交易的規模及數量，我們的國際貿易法律顧問已告知，本集團於中國供應商被指定為特別指定國民後與其進行的交易可被視為向特別指定國民提供「重大」協助。儘管如此，根據上述確認並經我們的國際貿易法律顧問告知，我們的董事認為，本集團與中國供應商的活動不大可能對有關人士引發執法風險，因為本集團的交易並非故意，不大可能損害美國制裁目標，且已採取即時及全面的補救措施，包括立即及迅速地縮減與中國供應商的交易。應用《美國聯邦法規》第31篇第501部附錄A所載OFAC的《經濟制裁執行指引》後，並經我們的國際貿易法律顧問告知，我們的董事認為，本集團的行為極有可能被OFAC歸類為「非嚴重」，而OFAC對有關人士施加二級制裁的風險為低。

### (iii) 採購美國原產組件

於往績記錄期間，若干根據《出口管理條例》被歸類為EAR99的美國原產組件被納入本集團的產品中。就「最低限度」規則而言，EAR99物項不被視為「受管制」物項。因此，我們的國際貿易法律顧問已告知，納入該等物項不會使本集團的產品受《出口管理條例》規限。本集團亦無於其產品設計及製造過程中使用美國原產的軟件及技術，因此，我們的國際貿易法律顧問已告知，本集團的產品不會因任何外國直接產品規則而受《出口管理條例》規限。

於往績記錄期間，本集團曾向實體清單上的若干中國客戶銷售。然而，我們的國際貿易法律顧問已告知，鑑於本集團的產品不受《出口管理條例》規限，有關銷售將不構成對《出口管理條例》的違反。

## 業 務

### 日本實施的國際制裁

就日本出口管制而言，於往績記錄期間，本集團從中國及中國台灣的供應商採購日本原產組件。該等日本原產組件不受《外匯及外國貿易法》(「FEFTA」)的管制。

我們的國際貿易法律顧問已告知，本公司的一名客戶於2020年5月8日被列入經濟產業省的最終用戶清單(「最終用戶清單」)。最終用戶清單向出口商提供有關外國實體的參考資料，該等實體被認為無法消除其參與大規模毀滅性武器或其他物項開發等活動的疑慮。由於本集團並無從日本向該客戶出口貨物，且FEFTA對非日本人士並無域外效力，我們的國際貿易法律顧問已告知，有關銷售不會在日本出口管制下產生重大風險。

### 歐盟實施的國際制裁

就有關歐盟出口管制(包括荷蘭的出口管制)而言，於往績記錄期間，本集團並無從歐盟出口或以其他方式採購任何受歐盟出口許可規定或歐盟出口管制項下其他出口限制所規限的物項(「受歐盟管制」)，且根據向我們供應商的查詢，其產品概不含受歐盟管制的歐盟原產物項。此外，於往績記錄期間，本集團並無從荷蘭出口或以其他方式從荷蘭採購任何物項。經我們的國際貿易法律顧問告知，我們的董事認為：(i)由於本集團的業務活動與荷蘭並無關連，荷蘭對半導體行業的補充出口管制亦與本集團無關；及(ii)本集團並無從事任何涉及歐盟出口管制限制或違反歐盟出口管制法律或法規的營運或交易。

### 英國和澳洲實施的國際制裁

經我們的國際貿易法律顧問進一步告知，我們的業務往來並未涉及英國和澳洲採納的限制性措施，主要原因是我們的業務活動並未與英國和澳洲產生足夠的關聯以觸發其制裁的適用。

### 評估本集團的國際制裁風險

經我們的國際貿易法律顧問告知，本公司並非受制裁目標，亦非位於、註冊成立於、組織於或居住於受制裁國家；且我們於往績記錄期間的銷售活動並不符合《指南》第4.4章所指的受制裁買賣商的資格。

就《指南》第4.4章而言，我們的國際貿易法律顧問已進一步告知，我們的業務活動(a)不構成主要受制裁活動；及(b)曾與受制裁客戶及一名中國供應商進行有限交易，但基於上文所述理由，該等活動不大可能引發執法風險。

## 業 務

我們承認，由於國際制裁制度瞬息萬變，與我們的業務活動相關的國際制裁風險無法完全排除。然而，鑑於我們的產品及最終用戶的性質，我們預期該等風險將維持在低水平且可控，且倘我們能證明遵守下文所討論的國際制裁，該等風險或可進一步減輕。

此外，我們已向聯交所承諾，我們將：

- (i) 不會直接或間接動用[編纂]及透過聯交所籌集的任何其他資金以(a)資助或便利任何受制裁活動；或(b)支付因終止或轉讓構成次級可制裁活動的相關合約而產生的任何損害賠償；
- (ii) 於[編纂]前終止構成次級可制裁活動的相關合約項下的所有責任，並制定措施確保遵守該等承諾；及
- (iii) 於我們的年度、中期及季度報告(如有)中披露(a)任何新增及／或現有主要受制裁活動或次級可制裁活動的詳情；(b)我們為監察業務所承受的制裁風險而作出的努力；及(c)任何新增及／或現有主要受制裁活動或次級可制裁活動的現狀及預期計劃。

### 我們為盡量降低國際制裁風險而採取的內部監控措施

為識別和監控我們與該等銷售相關的國際制裁風險，我們的法律部門已加強內部監控如下。

- (i) 委任具備足夠專業知識的專職人員，以監督本集團對制裁及出口管制合規承諾的持續加強及實施；
- (ii) 實施強化的制裁及出口管制合規政策，當中包括(但不限於)對所有現有及未來客戶、供應商及最終用戶進行充分的持續篩查、出口管制合規措施(例如，電子庫存控制及採購流程管理)以及於必要時進行制裁及出口管制培訓；
- (iii) 將制裁及出口管制相關條款納入與客戶及供應商就所有交易訂立的合約中；
- (iv) 於必要時為管理層、業務團隊及其他團隊進行制裁培訓；及
- (v) 將以制裁合規為重點的審核納入本集團的定期審核，包括附屬公司及經銷商的審核。

基於以上所述，國際貿易法律顧問認為，本公司法律部門新增的職責將能夠達到監控我們所面臨的國際制裁風險的目的。

## 業 務

我們將繼續與其他相關地區的非受制裁目標客戶進行交易，同時持續監控本集團的國際制裁風險，並依賴我們加強的內部監控措施。

於[編纂]後，我們將酌情實施額外措施，以盡量降低國際制裁風險。內控顧問對我們為應對與海外國家交易對手業務往來可能產生的國際制裁風險而加強的內部監控措施進行了後續審查。內控顧問並不知悉在我們為應對制裁風險而加強的內部監控措施的設計及實施方面存在任何重大缺陷(將於[編纂]後實施的內部監控措施除外)，且內控顧問在內部監控審查中並無任何進一步建議。

我們的國際貿易法律顧問已審查及評估該等內部監控措施，並認為，只要本集團能嚴格實施，該等措施將足以並有效地使本公司遵守適用的國際制裁法律。

經考慮我們國際貿易法律顧問的上述意見，我們的董事認為上述措施將提供一個合理充分及有效的框架，以協助我們識別和監控任何與國際制裁有關的重大風險。

經考慮我們的董事及國際貿易法律顧問的上述意見並進行相關盡職審查後，獨家保薦人並無注意到任何事宜，會合理地使其對我們的董事就本集團的國際制裁風險的上述意見在任何重大方面產生懷疑。

## 環境、社會及管治

我們將環境、社會及管治(ESG)管理視為與公司業務運營同等重要，將可持續發展理念融入公司運營、產品研發等過程。

### ESG管治

我們制定了《芯碁微裝ESG管理制度》，構建ESG管理架構。

董事會作為ESG工作的領導和決策機構，負責審議和批准公司的ESG發展戰略與目標、重大議題、管理架構、管理制度等ESG相關重要事項。董事會下設戰略與發展委員會，負責識別對公司業務具有重大影響的ESG相關風險和機遇，推動並監督ESG目標實現的進度，審閱公司ESG相關披露文件等事項。ESG工作小組負責貫徹落實公司ESG發展戰略與目標，組織和安排各執行單位實施ESG工作相關事項。ESG執行小組負責執行ESG工作計劃並定期匯報工作成果。

## 業 務

我們將可持續發展管理融入公司戰略和運營，將履行ESG職責納入經營管理決策體系，持續提升公司可持續表現。

### ESG重要性評估及風險管理

我們根據《環境、社會及管治報告守則》，通過行業對標研究等方式，識別公司重要ESG議題與潛在風險。

- 我們結合公司實際運營情況與行業發展趨勢，識別出與公司環境、社會與管治表現緊密相關的重要議題。
- 我們委聘外部專家提供專業建議及指導，從對公司發展的重要性和對利益相關方的重要性兩方面綜合考量，對ESG議題進行優先級次序排列，識別出高度重要性ESG議題，並將其融入公司ESG管理方針與策略中。

根據我們的重要性評估結果，我們認為產品質量與安全、職業健康與安全、排放物管理是我們關鍵的ESG事宜。

截至2025年12月31日，我們未發生任何與ESG相關的重大風險事件，未發生因違反環保、產品質量與安全、職業健康與安全等ESG相關法律法規而受到任何處罰的情況，未遭受ESG（包含氣候）相關風險對我們業務、策略及財務表現造成的任何實際影響或預期造成的潛在重大影響。

### 環境

我們遵守《中華人民共和國環境保護法》等法律法規及適用環保標準，制定了環境因素識別和評價控制程序、污染物控制程序，並獲得了ISO 14001環境管理體系認證。我們的環境績效表現符合行業標準。根據公開資料，我們的綜合能源消耗量及溫室氣體排放量（範圍1和範圍2）等關鍵環境績效數據均低於行業平均數。

於2023年、2024年及2025年，我們的環境合規成本分別約為13萬元、80萬元和35萬元。

我們結合業務發展現狀和環境管理水平，設定了以下環境管理目標：

- **環境管理**：環境污染事故0起。
- **溫室氣體減排**：以2025年為基準，2030年溫室氣體排放密度下降20%。

## 業 務

- **廢氣**：以2025年為基準，2030年空氣污染物排放量下降10%。廢氣達標排放率100%。
- **廢水**：廢水達標排放率100%。
- **廢棄物**：以2025年為基準，2030年有害廢棄物和無害廢棄物排放密度均下降5%。有害及無害廢棄物合規處置率100%。
- **能源使用效益**：到2028年，可再生電力較2024年增加50%，達到168萬千瓦時。
- **水資源使用效益**：以2025年為基準，2030年耗水密度下降10%。

### 排放物管理

我們嚴格遵守《大氣污染物綜合排放標準》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等排放物相關法律法規，制定了污染物控制程序，嚴格管理自身排放。

- **廢氣管理**：我們產生的廢氣主要為光刻工藝產生的揮發性有機物(VOCs)和基板清洗過程產生的硫酸霧。於2023年、2024年及2025年，我們的廢氣排放量分別約為1,544萬標準立方米、1,400萬標準立方米和1,912萬標準立方米。
- **廢水管理**：我們產生的廢水包括生活污水和工藝廢水，生活污水經隔油池和化糞池處理後排放市政污水管網，工藝廢水定期收集處理後回用不外排。於2023年、2024年及2025年，我們的生活污水排放量分別為10,154噸、10,281噸和15,758噸。
- **有害廢棄物**：我們產生的有害廢棄物主要包括生產過程中產生的廢機油、廢油水混合物、廢光刻膠、廢活性炭等。為進一步規範有害廢棄物的管理，我們制定了《污染物控制程序》等管理制度。所有產生的有害廢棄物均由專人運送至危廢庫房統一儲存，並做好詳細記錄。針對不同類別的有害廢棄物，我們採取相應的包裝方式，例如廢液存放於噸桶，廢活性炭則使用紙箱分區存放。我們委託具備資質的第三方單位對有害廢棄物進行合規處置，並在處置完成後獲取危廢轉移聯單作為憑證。於2023年、2024年及2025年，我們的有害廢棄物排放量分別為9.99噸、8.06噸和4.39噸；有害廢棄物排放密度分別為12.05千克／百萬營收、8.44千克／百萬營收和3.12千克／百萬營收。

## 業 務

- **無害廢棄物**：我們產生的無害廢棄物主要為生活垃圾、辦公垃圾及生產過程中的廢棄零部件，生活垃圾與辦公垃圾由資源回收單位統一回收處理，生產過程中產生的廢棄零部件按照既定流程及時退回原廠家。於2023年、2024年及2025年，無害廢棄物排放量分別為32.84噸、35.62噸和67.43噸；無害廢棄物排放密度分別為0.040噸／百萬營收、0.037噸／百萬營收和0.048噸／百萬營收。

### 能源資源管理

我們遵守《中華人民共和國節約能源法》，制定《能源資源控制程序》等管理制度，將節能降耗列為年度KPA，系統推進各項節能工作。

在用水方面，我們所用水源來自市政供水，未遇到水資源不足的情況。在生產運營方面，我們採用純水作為工藝用水，以降低更換頻率，提高用水效率。

在紙張使用方面，我們積極推行線上協同辦公，減少紙質文件流轉。

下表列示本公司於往績記錄期間的能源消耗情況：

| 指標                 | 單位       | 截至12月31日     |              |              |
|--------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|                    |          | 2023年        | 2024年        | 2025年        |
| 綜合能源消耗量.....       | 噸標煤      | 489.46       | 592.23       | 761.30       |
| 綜合能源消耗密度.....      | 噸標煤／百萬營收 | 0.59         | 0.62         | 0.54         |
| 用電量.....           | 千瓦時      | 3,588,550.56 | 4,285,667.94 | 5,475,535.38 |
| 清潔能源使用量(光伏發電)..... | 千瓦時      | 720,829.2    | 1,126,579.2  | 1,125,885.6  |
| 汽油消耗量(公務出行).....   | 升        | 14,959.5     | 15,066.13    | 13,677.82    |
| 外購熱力.....          | 吉焦       | 720.37       | 1,177.00     | 1,838.3      |
| 天然氣.....           | 立方米      | 5,846        | 6,900        | 8,229        |
| 耗水量.....           | 立方米      | 11,282       | 11,423       | 17,511       |

註：綜合能源消耗量計算方法參考《綜合能耗計算通則》(GB/T 2589-2020)。

## 業 務

### 應對氣候變化

我們致力於綠色低碳發展，持續完善氣候治理體系，重視氣候變化對公司潛在的影響。我們積極識別氣候相關風險和機遇，系統評估其對公司經營和發展的影響，並據此制定應對措施：

在物理風險方面，主要關注颱風、極端降水、極熱及極寒天氣，可能影響生產穩定和設備運行，對此我們通過應急預案、保險保障及設備防護等措施進行應對。

在轉型風險方面，我們關注法規趨嚴帶來的合規壓力和可能的商譽影響，同時把握能源效益帶來的機遇。為此，我們提升信息披露，推動低碳創新，並持續投資光伏發電，增強可持續發展能力。

通過倡導綠色辦公及低碳出行，安裝屋頂光伏以提升可再生能源使用比例，我們減少了電力消耗，增加了清潔能源的使用。

下表列示本公司於往績記錄期間的溫室氣體排放量：

| 指標                             | 單位               | 截至12月31日 |         |         |
|--------------------------------|------------------|----------|---------|---------|
|                                |                  | 2023年    | 2024年   | 2025年   |
| 範圍1溫室氣體排放量 .....               | 噸二氧化碳當量          | 12.64    | 14.92   | 17.99   |
| 範圍1溫室氣體排放密度 .....              | 噸二氧化碳當量/<br>百萬營收 | 0.015    | 0.016   | 0.013   |
| 範圍2溫室氣體排放量 .....               | 噸二氧化碳當量          | 2,094.9  | 2,536.7 | 3,140.4 |
| 範圍2溫室氣體排放密度 .....              | 噸二氧化碳當量/<br>百萬營收 | 2.53     | 2.66    | 2.23    |
| 範圍3溫室氣體排放量<br>(類別6—商務差旅) ..... | 噸二氧化碳當量          | 650.39   | 857.47  | 836.97  |

註：範圍1和範圍2溫室氣體排放量計算方法參考《機械設備製造企業溫室氣體排放核算方法與報告指南（試行）》，範圍1和範圍2溫室氣體排放因子參考生態環境部發佈的《關於發佈2022年電力二氧化碳排放因子的公告》。公司的範圍1溫室氣體排放主要來自生產運營過程中的天然氣消耗。範圍2溫室氣體排放主要來自外購電力和熱力。範圍3溫室氣體排放量計算方法參考《溫室氣體核算體系》(GHG Protocol)，排放因子參考中國產品全生命週期溫室氣體排放系數庫及美國環境投入產出模型數據庫(USEEIO database)的數據。

---

## 業 務

---

### 社會

#### 產品質量與服務

我們制定並執行《不合格品控制程序》《產品質量信息管理制度》等內部制度。於往績記錄期間，我們未發生因安全或健康問題導致的產品召回事件。

在產品質量管控方面，我們系統搭建統一的問題管理平台，實現生產全過程問題的標準化管理。2025年，我們籌備建設質量管理系統，推行各環節檢測結果的線上化管理，依托數據監測識別質量風險。

在優化客戶體驗方面，制定《客戶服務保證控制程序》《售後服務管理規範》等制度。針對客戶意見和投訴，我們實現從接收到閉環處理的全流程管控，提升客戶投訴響應效率。

在數據隱私與信息安全方面，我們制定並遵循《數據洩露事件管理制度》，成立信息安全委員會，定期開展信息安全數據安全方面的檢視和部署安排。於往績記錄期間，我們已通過信息系統安全等級保護第二級的測評。

#### 研發與創新

作為技術創新驅動型公司，我們積極推進前沿技術研發，制定《知識產權管理規定》，持續提升技術競爭力與產品市場優勢。

在知識產權保護方面，我們在項目關鍵節點開展知識產權風險評估，與專業知識產權第三方機構建立長期合作。

### 人力資本

#### 合規僱傭

我們遵循《中華人民共和國勞動法》及《中華人民共和國勞動合同法》，制定《員工行為準則》等內部管理制度，堅決禁止僱傭童工和強迫勞工等行為。於往績記錄期間，我們未發生任何僱傭童工或強迫勞動事件。

## 業 務

在招聘與僱傭方面，我們秉持開放與包容的理念，切實保障招聘全流程的公平性。在薪酬管理方面，我們嚴格遵守《工資支付暫行規定》等規章制度，構建具有市場競爭力的薪酬體系。下表載列於往績記錄期間中國全職僱員分佈情況：

| 指標                    | 單位   | 截至12月31日 |       |       |
|-----------------------|------|----------|-------|-------|
|                       |      | 2023年    | 2024年 | 2025年 |
| 員工總數 .....            | 人    | 539      | 679   | 795   |
| 按性別劃分的<br>員工人數 .....  | 男性 人 | 440      | 567   | 651   |
|                       | 女性 人 | 99       | 112   | 144   |
| 員工流失率 .....           | %    | 12.24    | 11.78 | 14.88 |
| 按性別劃分的<br>員工流失率 ..... | 男性 % | 11.59    | 12.17 | 16.00 |
|                       | 女性 % | 15.15    | 9.82  | 8.86  |

### 員工健康與安全

我們嚴格遵循《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》等法律法規，建立健全安全生產責任制，已獲得ISO 45001職業健康安全管理體系認證及安全生產標準化三級認證。於往績記錄期間，我們沒有發生任何因工傷亡的事故，因工傷損失工作日數為0天。

### 員工培訓與發展

我們建立公平的績效與晉升機制，為員工提供管理序列與專業序列雙通道發展路徑。於2023年、2024年及2025年，我們的僱員平均受訓時數分別為24小時、25小時及29小時。

| 指標                     | 單位   | 截至12月31日 |       |       |
|------------------------|------|----------|-------|-------|
|                        |      | 2023年    | 2024年 | 2025年 |
| 按性別劃分的<br>受訓員工佔比 ..... | 男性 % | 82.88    | 83.52 | 81.66 |
|                        | 女性 % | 17.12    | 16.48 | 18.34 |

### 責任供應鏈

我們持續完善供應商管理體系，制定《供應商管理控制程序》《供應商導入管理規範》等制度，規範供應商尋源開發、績效評價、變更退出等全流程管理。

---

## 業 務

---

供應商准入階段，我們關注環境與社會相關風險，重點考核供應商在產品質量、環境保護、勞工權益、員工健康與安全、商業道德以及知識產權保護等ESG方面的績效表現與相關資格認證情況。我們要求供應商提供環境、質量等相關管理體系認證證書，亦將供應商ESG合規性要求納入供應商合同中，將《保密協議》《安全協議》《廉潔協議》作為與供應商簽訂的具有法律約束力的補充附件，抵制採購及供應商履責過程中發生任何不正當競爭及貪污腐敗等行為。

我們遵循《供應商導入管理規範》，通過收集供應商的環境管理體系證書、環境管制物質保證書等各類資質文件，以了解供應商的環境資質水平。在供應商審核階段，我們對供應商的ESG表現進行持續監控。通過週期性的績效考核，我們要求供應商對不符合項進行跟蹤整改，持續提升供應商質量。

### 商業道德

我們嚴格遵循《中華人民共和國反壟斷法》，制定《公司投訴舉報管理制度》等內部制度，設立並公示多途徑舉報渠道，規範舉報程序及受理流程，嚴格保護舉報人信息。於往績記錄期間，公司未發生貪污訴訟案件。

### 公益慈善

在公益實踐方面，公司設立合肥市婦聯婦兒關愛公益項目，切實幫扶婦女兒童群體，組織「百社進百村」脫貧攻堅活動，助力鄉村發展。自2023年至2025年，我們公益捐贈累計150,000元。

### 物業

我們在中國擁有及租賃物業，用作生產、研發及辦公用途。截至最後實際可行日期，我們所有的生產基地均位於中國。我們的總部位於中國合肥。

截至最後實際可行日期，我們持有或租賃的物業概無賬面值佔我們綜合總資產15%或以上。根據公司(豁免公司及招股章程遵守條文)公告第6(2)條，本文件獲豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例第342(1)(b)條的規定，即無須按公司(清盤及雜項條文)條例附表三第34(2)段所述，將所有土地或房屋及建築物權益載入估值報告。

## 業 務

### 自有物業

截至最後實際可行日期，我們在中國持有兩幅地塊的土地使用權，總地盤面積約為53,150.3平方米。該等地塊均已獲授土地使用權證。截至最後實際可行日期，我們在中國擁有六處物業，總建築面積約為35,962.4平方米。該等地塊及物業主要用作業務營運、生產及倉儲。

於往績記錄期間，我們生產基地的若干臨時建築（包括總面積約370.5平方米的停車棚，佔我們自有總建築面積不到1.5%）尚未根據中國法律法規取得房屋所有權證。該等建築物乃作輔助用途而建，且根據有關法律法規及監管機構的回覆，無需取得規劃許可證或房屋所有權證。我們並無法律規定須為該等建築物取得該等證書，且我們不會因未取得該等證書而受到任何處罰或罰款。誠如我們的中國法律顧問所告知，未持有該等證書並不影響我們對主廠房及土地的實際佔有或使用，該等主廠房及土地並無所有權糾紛。截至2025年12月31日，包裝廢料室已拆除。董事認為，由於該等建築物對我們的核心生產或日常營運並非至關重要，我們的業務營運及財務狀況將不會受到重大影響。此外，根據相關建設主管部門出具的確認函，我們於往績記錄期間已遵守適用的建設法律法規，且並未受到任何行政處罰或不良信用記錄。我們的中國法律顧問認為，有關當局有權出具該確認書。

我們的董事認為，該等臨時建築的瑕疵不會對我們的業務、經營業績或財務狀況造成重大不利影響，乃基於以下各項：(i)我們的廠房及相關土地並無所有權糾紛；(ii)該等臨時建築乃作輔助用途，佔我們廠房總面積的比例很小；(iii)於往績記錄期間，我們概無因建設事宜而受到任何行政處罰或不良信用記錄；(iv)倘被要求拆除該等建築，我們的正常生產及經營不會受到重大影響；及(v)我們已取得單一最大股東組別出具的彌償保證函，就該等不合規行為所產生的任何索償、罰款及其他負債向本集團作出彌償。

截至最後實際可行日期，我們的主要在建工程為合肥生產基地（二期）的配套工程。截至最後實際可行日期，我們未按中國法規規定，就合肥生產基地（二期）向安徽省投資項目在線審批監管平台悉數提交若干項目資料，因而可能面臨被主管部門責令限期整改或處以罰款的風險。我們已啟動準備及補充未完成申請材料的程序，且正積極與有關部門溝通以確保完全合規。我們已自合肥高新技術產業開發區經濟貿易局取得書面確認，確認截至該

## 業 務

確認日期，概無發現有關提交合肥生產基地(二期)項目資料的違法違規、行政處罰或監管措施。我們的中國法律顧問認為，截至最後實際可行日期，我們並未就此事收到相關主管部門的任何整改通知，亦不存在逾期未整改的情況，本公司就此事受到行政處罰的風險較低。

此外，於往績記錄期間，我們的合肥生產基地(二期)項目未在土地出讓合同規定的時間表內竣工。竣工延遲乃主要由於客觀因素所致，包括土地交付時整體規劃方案的多次調整、場地準備、與相關當事方協調，以及影響開工及施工進度的其他實際因素，而該等因素並非歸因於我們。經有關政府部門確認，該等延遲並非因本集團的任何過失或主觀原因所造成。截至最後實際可行日期，我們已完成所有主要建設工程並取得竣工驗收，且未接獲土地管理部門要求支付違約賠償金的任何要求，亦未就此受到任何行政處罰。

根據本集團與合肥市自然資源和規劃局就合肥生產基地(二期)訂立的土地出讓合同及其補充條款，當中訂有罰則條款，倘若未能在規定時限內開工或竣工，則可根據適用法律法規追究違約責任。具體而言，該土地出讓合同規定，倘承讓人未能按約定動工或竣工，合肥高新技術產業開發區管理委員會將釐定及追究相關違約責任。截至最後實際可行日期，合肥高新技術產業開發區管理委員會已出具書面確認函，當中述明由於開工及竣工延遲乃因客觀因素所致，並非歸因於本集團，故不會就該延遲向本集團追究任何責任、賠償或處罰。該書面確認進一步指出，延遲竣工將不會影響本集團隨後申請及取得合肥生產基地(二期)項目的相關物業所有權證的能力，亦不會影響該項目合法開始生產及營運。我們的中國法律顧問認為，合肥高新技術產業開發區管理委員會有權出具該確認書。誠如我們的中國法律顧問所告知，基於上述確認及中國相關法律法規，我們超出備案設計產能的生產並不構成重大不合規。

截至最後實際可行日期，我們正在整理及準備就合肥生產基地(二期)進行完整合法業權登記所需的申請材料。基於上述事實，我們的中國法律顧問合理及可預見地認為，在辦妥所需程序後，取得該等物業的完整合法業權並無法律障礙。我們計劃待取得所有必要的監管批准及完成產權登記後，方會於合肥生產基地(二期)正式投產。

我們的董事認為，上述瑕疵不會對我們的業務、經營業績或財務狀況造成重大不利影響，原因為(i)我們並未被發現曾犯有任何與項目資料提交或延遲竣工相關的重大違規行為，或接獲任何相關的行政處罰或監管措施；(ii)延遲竣工並未導致任何土地閒置、沒收風險或行政處罰；及(iii)我們已取得單一最大股東組別出具的彌償保證函，就該等不合規行為所產

## 業 務

生的任何索償、罰款及其他負債向本集團作出彌償。基於上述事實，截至最後實際可行日期，我們尚未為上述不合規事宜所引致的潛在負債作出任何撥備，而我們董事認為此乃屬充分及適當。

### 租賃物業

截至2025年12月31日，我們在中國租賃了兩處物業，主要用作辦公及生產用途，總建築面積約為342.9平方米。租賃期通常為二至五年。截至2025年12月31日，上述租賃協議均已在適當的政府機關登記。

### 牌照、批准及許可證

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，經中國法律顧問告知，我們已取得我們經營所在司法管轄區業務營運所需的所有重大及必要的牌照、批准、許可證及證書，且該等牌照、許可證、批准及證書均屬有效及存續。

### 法律訴訟及合規

我們可能不時因日常業務過程而面臨各種法律或行政索賠及程序。訴訟或任何其他法律或行政程序，不論結果如何，均可能導致大量成本及資源的轉移，包括我們管理層的時間及精力。截至最後實際可行日期，我們及我們的各主要附屬公司並無涉及任何我們認為可能對我們的資產與負債或利潤與虧損具有重大重要性的法院、仲裁或行政訴訟，且就我們所知，亦無任何該等正在待決或面臨威脅的訴訟。

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無涉及任何已導致罰款、執法行動或其他處罰的重大不合規事件，而該等事件可能個別或共同對我們的業務、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。

### 風險管理及內部監控

我們在營運過程中面臨各種風險。我們已制定一套內部監控及風險管理政策與程序，以應對與我們營運相關的潛在營運、財務、法律及市場風險。我們亦定期審查該等程序以確保其有效性。我們的政策及程序涉及管理我們的採購及生產，以及監控我們的銷售業績及產品質量。

為監控我們風險管理政策及企業管治措施的持續實施，我們已採納或將繼續採納(其中包括)以下風險管理措施：

- 設立審計委員會以審查及監督我們的財務報告流程及內部監控系統。有關委員會成員的資格及經驗，請參閱「董事及高級管理層 — 董事會轄下委員會 — 審計委員會」；

## 業 務

- 採納政策以確保遵守上市規則，包括但不限於與風險管理、關連交易及信息披露相關的方面；
- 為我們的董事及高級管理層組織有關上市規則相關規定及香港上市公司董事職責的培訓課程；
- 定期向我們的高級管理層及僱員提供有關專業行為要求及道德標準的培訓課程，以增強彼等對適用法律法規的了解及遵守，並將相關的反不合規政策納入我們的僱員紀律措施及監督指引中；
- 加強我們工廠的報告及記錄系統，包括集中其質量控制及安全管理系統，並對設施進行定期檢查；
- 建立一套應對重大質量相關問題的應急程序；
- 提供有關質量保證及產品安全程序的強化培訓計劃；及
- 分發僱員手冊，以提高僱員遵守法律法規的意識。

## 數據隱私政策

我們致力於確保數據隱私及信息安全。我們不從事通過營運網站或應用程式等公共渠道收集私人信息的活動，我們收集的數據有限。在開展業務過程中，我們收集的唯一隱私數據主要涉及僱員信息、客戶及供應商聯繫信息以及營運及管理所需的其他數據。我們確保從我們的僱員、客戶及供應商處獲得足夠的授權及同意，以收集及處理彼等的私人信息。

於我們的業務營運過程中，我們高度重視數據隱私及信息安全。我們在收集數據時遵循最小化及必要性原則，目前僅通過我們的指定系統收集有限的個人信息，例如僱員及客戶的姓名及電話號碼。該等數據不存儲於本地數據庫，除非絕對必要，否則我們不會通過接口傳輸該等數據。敏感數據在任何外部傳輸前亦會進行脫敏處理。

為防止數據洩露及外部入侵，我們已採取零信任訪問控制及安全網關系統等安全措施。我們亦已制定規則及審批程序，以監控及管理訪問我們內部網絡的異常嘗試。所有該等活動均須經過必要的審查及可追溯，從而確保內外部數據分離及隱私保護。

我們亦已建立數據獲取及審批流程，據此，在進行任何數據提取或分析前，訪問我們系統內的敏感數據須經公司統一程序確認。此外，我們已實施數據存儲及備份措施，以確

## 業 務

保數據不會丟失或無法恢復。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無經歷任何重大信息洩露或營運或交易數據丟失，亦無因數據隱私而受到任何投訴、調查或法律訴訟。

### 獎項及認可

我們在產品、技術及創新方面已獲得多個獎項及認可。下表載列我們於往績記錄期間及直至最後實際可行日期獲得的主要獎項及認可：

| 年度         | 獎項／認可                       | 頒授實體              |
|------------|-----------------------------|-------------------|
| 2026年..... | 國家知識產權示範企業                  | 國家知識產權局           |
| 2025年..... | 2024年度中國電子電路行業(專用設備和儀器)百強企業 | 中國電子電路行業協會        |
| 2024年..... | 第十一屆安徽省專利金獎                 | 安徽省市場監督管理局        |
| 2024年..... | 安徽省優秀民營企業                   | 中共安徽省委，安徽省人民政府    |
| 2024年..... | 安徽省勞動競賽先進集體                 | 安徽省總工會，安徽省勞動競賽委員會 |
| 2024年..... | 安徽省五一勞動獎狀                   | 安徽省總工會            |
| 2023年..... | 國家級專精特新「小巨人」企業              | 中華人民共和國工業和信息化部    |
| 2023年..... | 2022年度中國電子電路行業(專用設備和儀器)百強企業 | 中國電子電路行業協會        |
| 2023年..... | 2023年度安徽省首台(套)重大技術裝備認定      | 安徽省經濟和信息化廳        |